



株式会社TMH

事業計画及び成長可能性に関する事項

東証グロース市場 / 福証Q-Board市場：280A

2026年2月16日

AGENDA

01	会社概要	P 3
02	事業内容	P17
03	市場環境	P26
04	競争優位性	P34
05	成長戦略	P42
06	リスク情報	P61

01 会社概要

会社概要

会社名	株式会社TMH
代表取締役社長	榎並 大輔
所在地	大分県大分市下郡北3-14-6
設立	2012年3月9日
従業員数	45名（2025年11月末時点、連結ベース）
資本金	2億9909万円（2025年11月末時点）
事業内容	半導体製造フィールドソリューション事業 （装置・部品の販売・修理、越境ECサイト LAYLA-ECの運営）
事業所	大分本社・中部支店・関東支店 ・東北出張所・九州支店（熊本）
海外子会社	1社（大韓民国 平澤市）

国内 **5拠点 + 韓国** に展開





株式会社TMHは、Technology Makes Happinessの
頭文字から社名が構成されています。

MISSION

先端技術で豊かな社会を創ること

VISION

最高のバリューを提供し続けること

会社紹介

半導体市場において半導体工場の稼働を様々なかたちで支援するリーディングカンパニー



半導体業界が直面する様々な社会課題を解決する リーディングカンパニー

領域

巨大な
半導体業界

提供する価値

半導体製造装置の延命
メンテナンスコストの軽減

特徴

ニッチトップ
かつ
高成長

当社が必要とされる背景

老朽化した半導体工場には、多様なサプライチェーン課題が山積した状態

調達課題

- 日本の工場の多くは**陳腐化・老朽化が進み**、**レガシー半導体製造装置**が多く、**部品の調達が困難**
- レガシー半導体製造装置部品の調達は、属人的な調達手法が中心（**デジタル化の遅れ**）

製造課題

- IoT（Internet of Things）により急速な需要の高まりにより、**旧型装置の需要が継続**
- 長期的な国内半導体市場の低迷により、**エンジニア人材が枯渇**
- レガシー半導体工場では**設備保全の属人化が常態化**、装置トラブルが品質問題や大規模な納期遅延に発展

物流課題

- 部品取りのために購入した**旧型装置の保管が常態化**することで**生産スペースを圧迫**

当社が目指す未来

半導体製造に関する多様な課題を解決し、
日本のものづくりの復権を支えます

マネジメントチーム

半導体製造装置の専門家が不足するなか、半導体・サプライチェーンの専門家にて構成



榎並大輔 Taisuke Enami
代表取締役
CEO

早稲田大学卒業後、株式会社東芝に入社。
東芝在籍中にサプライヤー管理に課題を感じ独立。
創業以来連続増収を実現。
2020年には大分県から地域牽引企業として選定



香月賢一 Kenichi Katsuki
取締役 COO

株式会社東芝入社後、20年以上購買・調達に従事。2012年には東芝本社調達部の集約部材に配属。年間数十億円のコストダウンや改善を実現。2016年にTMHに参画



関真希 Maki Seki
取締役 CFO

大手事業会社、デロイト・マツコンサルティング社にて経営改革に従事。グローバルコスト構造の可視化、M&A等サプライチェーン観点から多数のプロジェクトに従事。2015年にTMHに参画

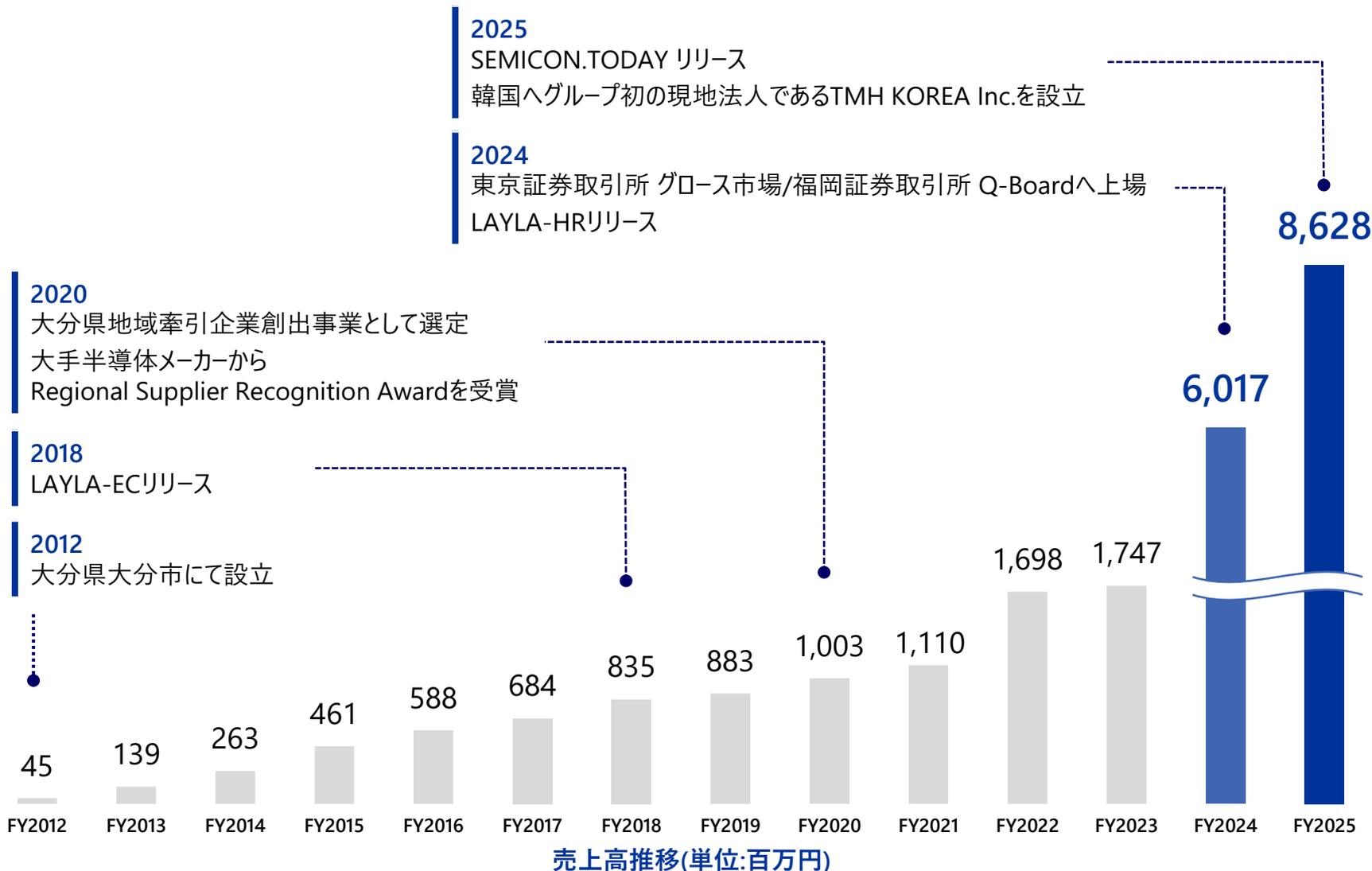


野木村修 Osamu Nogimura
社外取締役

名古屋大学卒業後、日立製作所に入社。
ルネサステクノロジ生産本部長、ルネサスエレクトロニクス執行役員
生産本部本部長、ルネサスセミコンダクターパッケージ&テストソリューションズ
代表取締役社長を歴任。一貫して半導体製造部門に従事

沿革

LAYLAプラットフォーム、装置販売事業の拡大により設立から継続して成長



2025年11月期 通期 連結業績サマリ 前年実績/当初計画対比

FY2025は売上高が前年比43.4%増と急成長。営業利益も前年を上回り、着実な成長を継続

売上・利益ともに大幅に伸長し、業績が大きく改善
特に装置販売ビジネスが好調で、前年対比で全社売上高は43.4%増の成長となった

(単位：百万円)

	FY2024 実績	FY2025 実績	YoY 増減	YoY 増減率	FY2025 計画 (上限)	計画比	計画比率
売上高	6,017	8,628	+2,611	43.4%	8,366	+262	+3.1%
売上総利益	862	970	+107	+12.5%	1,011	△40	△4.0%
営業利益	323	355	+32	+9.9%	366	△10	△2.8%
営業利益率	5.4%	4.1%	△1.3pt	-	4.4%	△0.3pt	-
経常利益	306	338	+32	+10.6%	356	△17	△4.9%
当期純利益	272	249	△23	△8.5%	240	+9	+3.9%

- 売上高** : 高度なエンジニアリング力が求められる装置の解体・搬出を伴う案件の増加や、大型装置案件の獲得に伴い増収
- 営業利益** : 装置販売事業の比率拡大に伴う売上総利益率の低下、新規事業立ち上げに関するコスト負担が生じたものの、トップラインの拡大により増益
- 経常利益** : 補助金等の収入、上場関連費用等の費用など、スポット要因による変動
- 当期純利益** : 繰越欠損金の解消により、支払法人税が正常化したことによる減益

※2024年11月期は非連結のため、参考として単体数値を記載しております

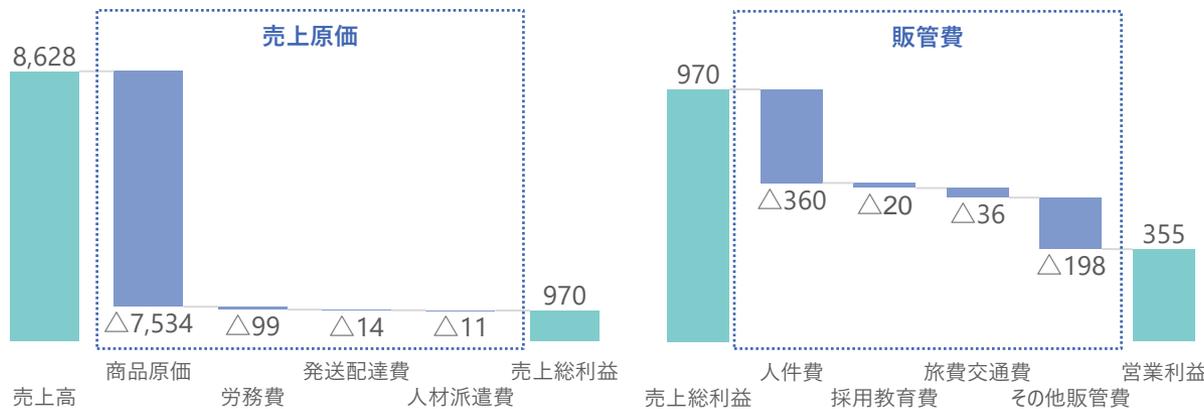
2025年11月期 利益構造および利益変動分析

粗利率を下げつつもトップライン伸長施策によりシェア拡大、前年対比で営業利益10%成長を実現

売上高・売上原価は装置販売の構成比率が高く、販管費は主に人件費・採用費で構成
装置販売がトップラインの伸長を牽引し、販管費は増加したものの、YoYで営業利益10%成長を実現

FY2025 利益構造

(単位：百万円)



売上原価

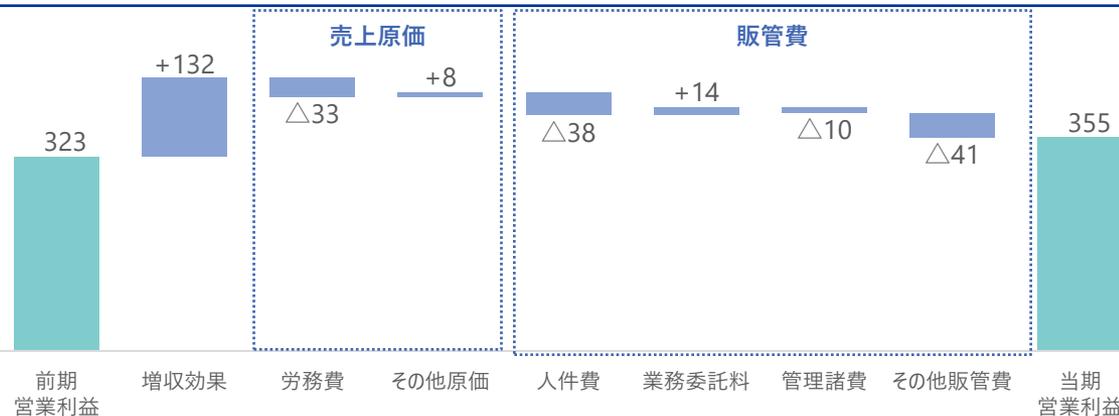
- ・装置販売の商品原価：6,620百万円
- ・部品販売・修理等の商品原価：913百万円
- ・労務費：フィールドエンジニアリングの人件費

販管費

- ・人件費：役員、営業、管理部門の人件費
- ・採用教育費：主に中途採用費
- ・その他販管費：監査費、委託費、地代家賃、システム費、等

利益変動分析 (YoY)

(単位：百万円)



増収効果

- ・主に装置販売の伸長に伴う増収

売上原価

- ・フィールドエンジニアリング要員の採用増

販管費

- ・人件費：営業、管理部門等の採用増
- ・租税公課：外形標準課税の増
- ・管理諸費：システム費、上場維持費用等の増
- ・その他販管費：営業活動強化費（旅費交通費、広告費、交際費）、地代家賃、等の増

2025年11月期 連結貸借対照表

前受金は将来的に売上へと変わるものであり、実質的な自己資本比率は前年対比で改善

(単位：百万円)

資産の部

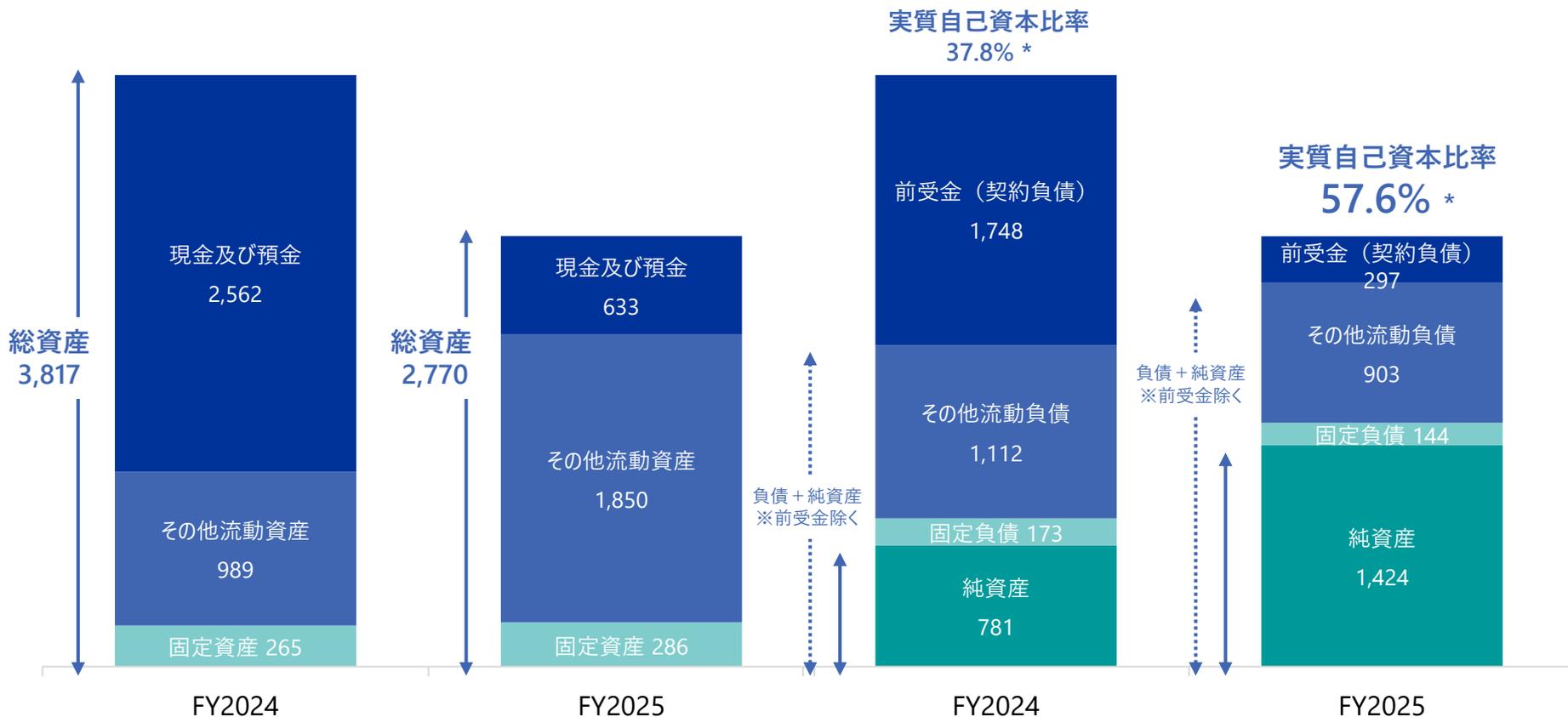
現金及び預金：FY2024は、大型装置販売案件における前受金により増加

その他流動資産：FY2025は、装置在庫により一時的に増加

負債・純資産の部

前受金（契約負債）：前受金の当期売上計上により減少

純資産：上場による増資、当期利益により増加



*前受金（契約負債）控除後の自己資本比率

2025年11月期の事業トピックス

グローバル調達力・技術力の強化

①韓国大手半導体メーカーからの調達網の確立

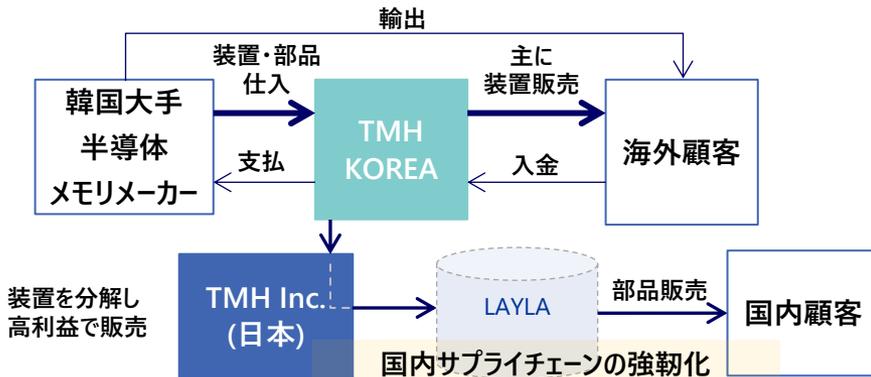
概要

- 韓国平沢市に当社初の子会社を設立（2025年7月）
- 韓国大手半導体メモリーメーカーの入札参加を契機に半導体製造装置のグローバル調達網を構築
- 韓国での装置調達・販売体制を強化し、エンジニアリング力を活かした装置販売と越境EC「LAYLA」の展開拡大を図る



ビジネスモデル

韓国内で半導体製造装置・部品を調達し、主に装置を海外へ販売、部品を親会社を通じて日本国内で販売

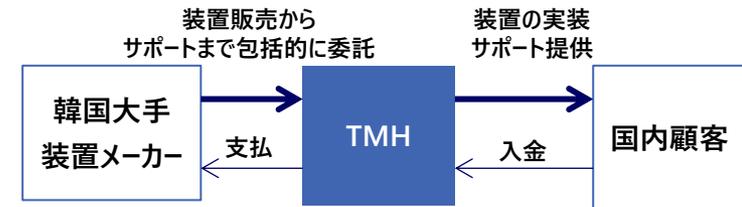


②韓国大手装置メーカーとの代理店権利獲得

概要

- 韓国の装置メーカーと、日本国内の装置販売における独占的代理店契約を締結
- 当社としては、新たに最先端の装置に関する事業領域を拡大する取り組み
- 先端技術の新たな獲得、国内先端工場への販路拡大によるシナジーを見込み、さらなる発展へ

ビジネスモデル



当社が積み上げてきた実績、信頼が呼び水となり本取組が実現
新品装置販売・保守メンテにより更なる収益拡大へ

2025年11月期の事業トピックス

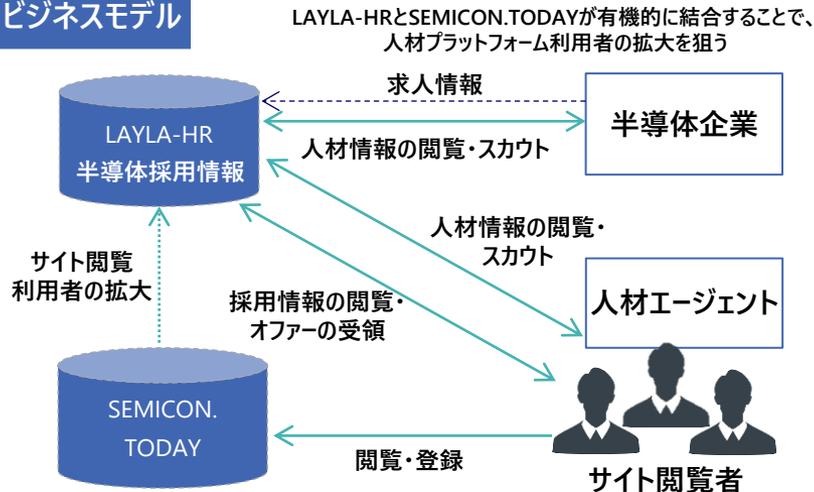
LAYLAプラットフォームの領域拡大

③LAYLAプラットフォームの広がり

概要

- LAYLA-HR（2024年12月）
 - 半導体業界特化型の人材プラットフォームとして、企業と個人をシームレスに結びつけるマッチングを提供
- SEMICON.TODAY（2025年7月）
 - 半導体業界に特化したメディアサイト。世界中の半導体産業に関する最新動向、業界リーダーの発言・動静、各国政府の政策方針、統計データ、など幅広いトピックを提供

ビジネスモデル



ヒトと情報のプラットフォーム機能拡充

LAYLAプラットフォームを拡充し、更なる付加価値を提供

LAYLAの認知度向上

業界No.1の情報メディアの新設による認知度向上

クロスセル

「モノ」、「ヒト」、「情報」の最重要資源を当社にて統合し、ワンストップで提供することにより、各サービスのクロスセルを図る



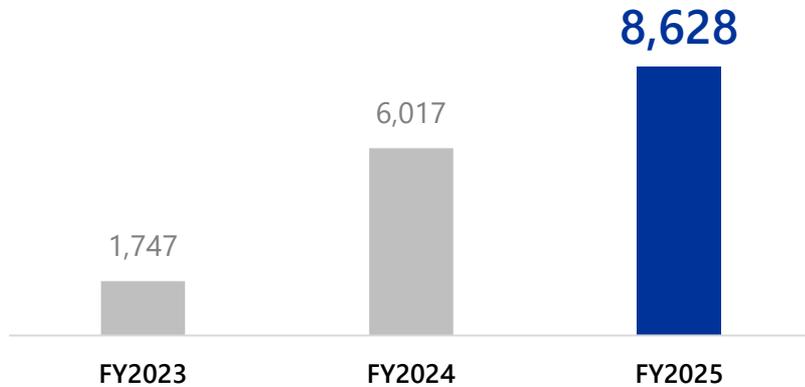
重要な経営指標（2025年11月期より連結ベース）

急成長と黒字化を両立し、非連続な成長ステージへ進むための土台が整う

3期連続の最終利益 黒字達成！ 2期連続の営業利益 増益！

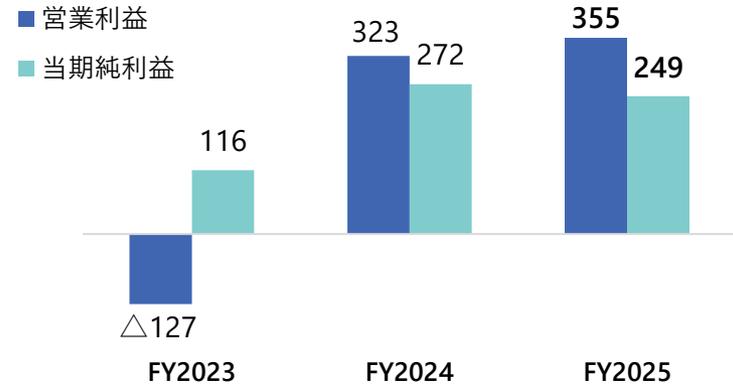
売上高

(単位:百万円)



営業利益・当期純利益

(単位:百万円)



収益性の向上

売上高成長率
YoY +**43.4%**

LAYLA売上 CAGR
+**34.9%**

装置売上実績
7,403百万円



財務安全性/投資効率性

CCC
(キャッシュ・コンバージョン・サイクル)

19.5日

※棚卸回転期間+売上債権回転期間-仕入債務回転期間
※装置販売ビジネスは基本的に前受金受領後に仕入支払い

ROE
22.6%

実質自己資本比率
57.6%



人的資本（単体）

外国籍従業員数（外国籍比率）
12人（27.9%）

離職率
15.4%

※離職率=退職者数6名+期初従業員数39名
※「令和6年雇用動向調査結果」の
全国平均離職率14.2%

※2024年11月期以前は非連結のため、参考として単体数値を記載しております

2025年11月期 KPI（事業）

売上高拡大に伴い、売上高関連指標が大幅に向上

受注残はYoYで減少の一方、FY2026以降を見据えた入札案件が複数予定
当期の業績に寄与する案件をさらに積み上げ拡大を見込む

(単位：百万円)

KPI		2024年11月期 4Q末 ※	2025年11月期 4Q末	YoY 増減率
未来の業績に関する指標	装置販売サービス 受注残総額	6,230	1,375	-78%
過去の業績傾向に関する指標 (累計)	(越境ECプラットフォーム) 部品販売・修理サービス売上高	902	1,213	+34%
	(エンジニアリング) 装置販売サービス売上高	5,109	7,403	+45%
生産性に関する指標 (売上高・純利益は累計)	従業員一人当たり売上高	154	192	+24%
	従業員一人当たり純利益	6.0	5.5	-7%

※2024年11月期は非連結のため、参考として単体数値を記載しております

受注残とは受注契約から将来に期待される収益の総額を意味しております。つまり、受注残が積みあがることは将来の業績への寄与が見込まれることとなります

02 事業内容

事業内容 ～半導体製造フィールドソリューション事業の概要～ トータルソリューションの提供により、半導体工場の稼働を支援

半導体工場へのトータルソリューションサービスを提供

越境ECプラットフォーム等を利用した部品販売・修理サービス

世界中の半導体製造装置・部品の売買にプラットフォームを活用



【サービス内容】

- ✓ 希少部品の供給
- ✓ 幅広い修理サービスの提供

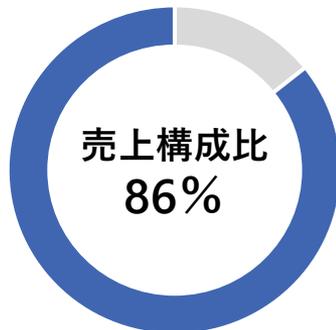
【実績】

- ✓ 200社超の優良なグローバルサプライヤー（多種多様なメンテナンスや部品供給）
- ✓ 36.9万点超のアイテム数、50%超の国内半導体工場が導入済み



エンジニアリング力を活用した装置販売サービス

装置解体、移設、搬出、プロセスチューニング、立上げサービスを提供



【サービス内容】

- ✓ 専門性が必要な装置の解体から搬出まで一気通貫でのサービス提供
- ✓ 旧型装置のプロセスチューニングによる歩留まりの改善

【実績】

- ✓ 大手米国半導体メーカーからサプライヤーアワード受賞
- ✓ 過去の実績を持つ信頼性（半導体製造装置の取引、100台超）



2025年11月期実績

事業内容 ～半導体製造フィールドソリューション事業の海外売上高推移～ トータルソリューションの提供により、海外売上高も順調に推移

海外売上高の推移



(単位:百万円)

海外展開の状況

エンジニアリング力を活用した装置販売により、海外売上高比率が拡大

- 当社は創業当初、国内の半導体工場向けに部品販売や修理サービスを提供しておりましたが、事業およびサービス領域の拡大に伴い、海外売上高比率が増加しております。
- 部品販売や修理サービスは地理的な制約から国内売上が大半を占めています。一方で、半導体製造装置の販売については、国内外を問わず案件の獲得を目指しております。2025年11月期において、新規顧客開拓による海外売上が大きく伸長したことで、海外売上高比率が拡大しております。

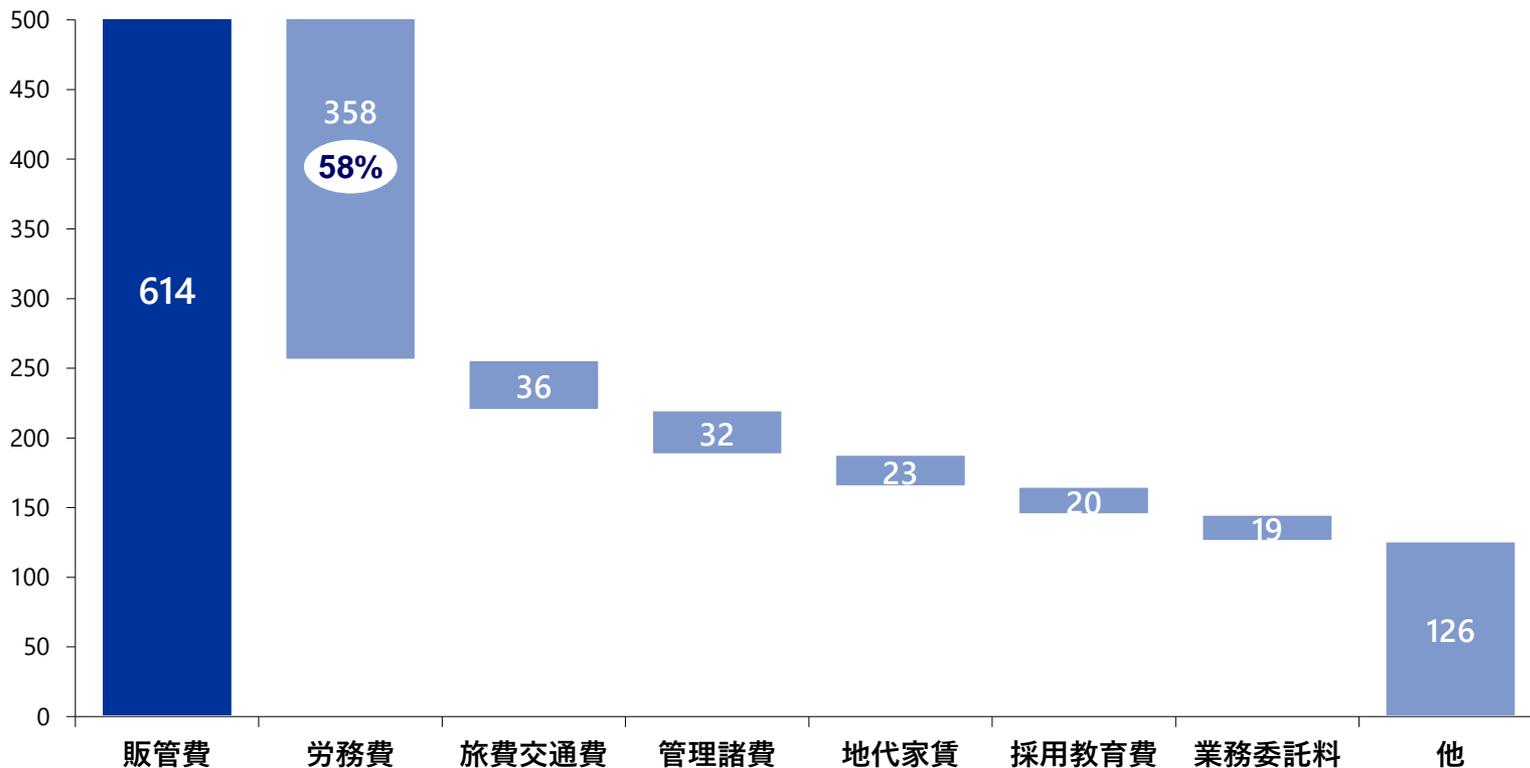
※2024年11月期以前は非連結のため、参考として単体数値を記載しております

事業内容 ～半導体製造フィールドソリューション事業の費用内訳～

販管費の主要な費用は、労務費で構成されており、人材への投資が当社の強みへとつながっている

2025年11月期 販売費及び一般管理費の主要な支出項目

単位：百万円



販管費内訳

出所：25年11月期、販管費実績

ビジネスフロー

ECプラットフォームとエンジニアリングを融合し、半導体工場の持続的な稼働を支援

- 世界中のエンジニアリング会社やサプライヤーと協業し、部品の修理や販売、歩留まりの改善、不要装置・部品の買取など、お客様の課題に対して幅広いソリューションを提供
- LAYLAでは世界中の装置・部品のデータを集積し、半導体製造装置の調達プロセスを効率化
半導体工場における半導体製造装置の効率的な運用と持続可能性に貢献

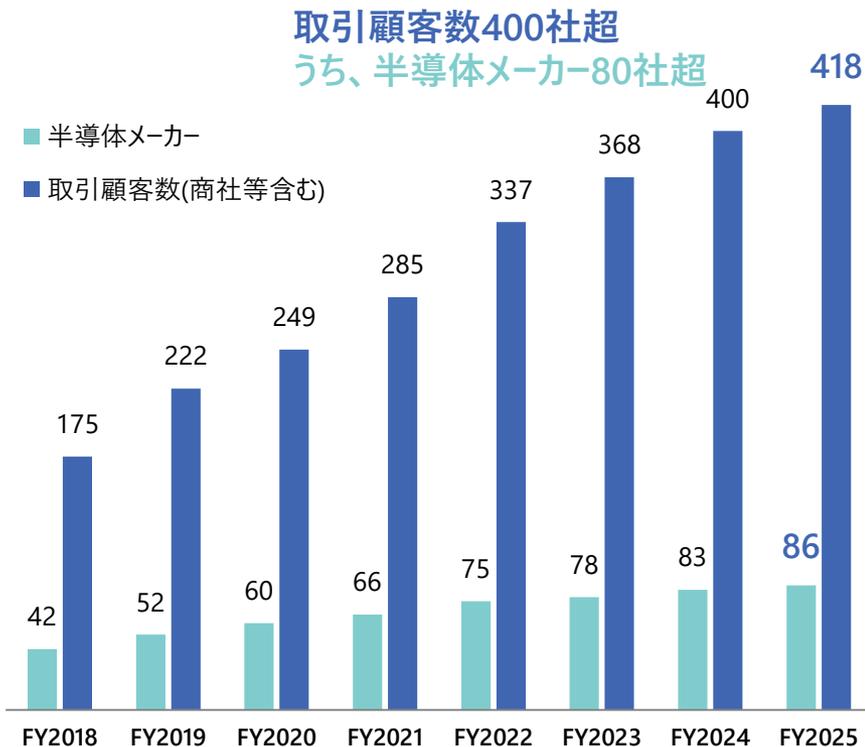


顧客

越境ECサイトを活用した圧倒的な調達力により、国内の半導体メーカーとの直接取引を拡大

- 国内ほぼすべての半導体メーカーと直接取引口座を開設済み
- 顧客のうち半導体メーカーは80拠点超。その他顧客も含めて全ての取引顧客数で300社超
- LAYLA-ECの展開により、海外半導体メーカーとの取引も拡大

顧客数推移



国別クライアントマップ

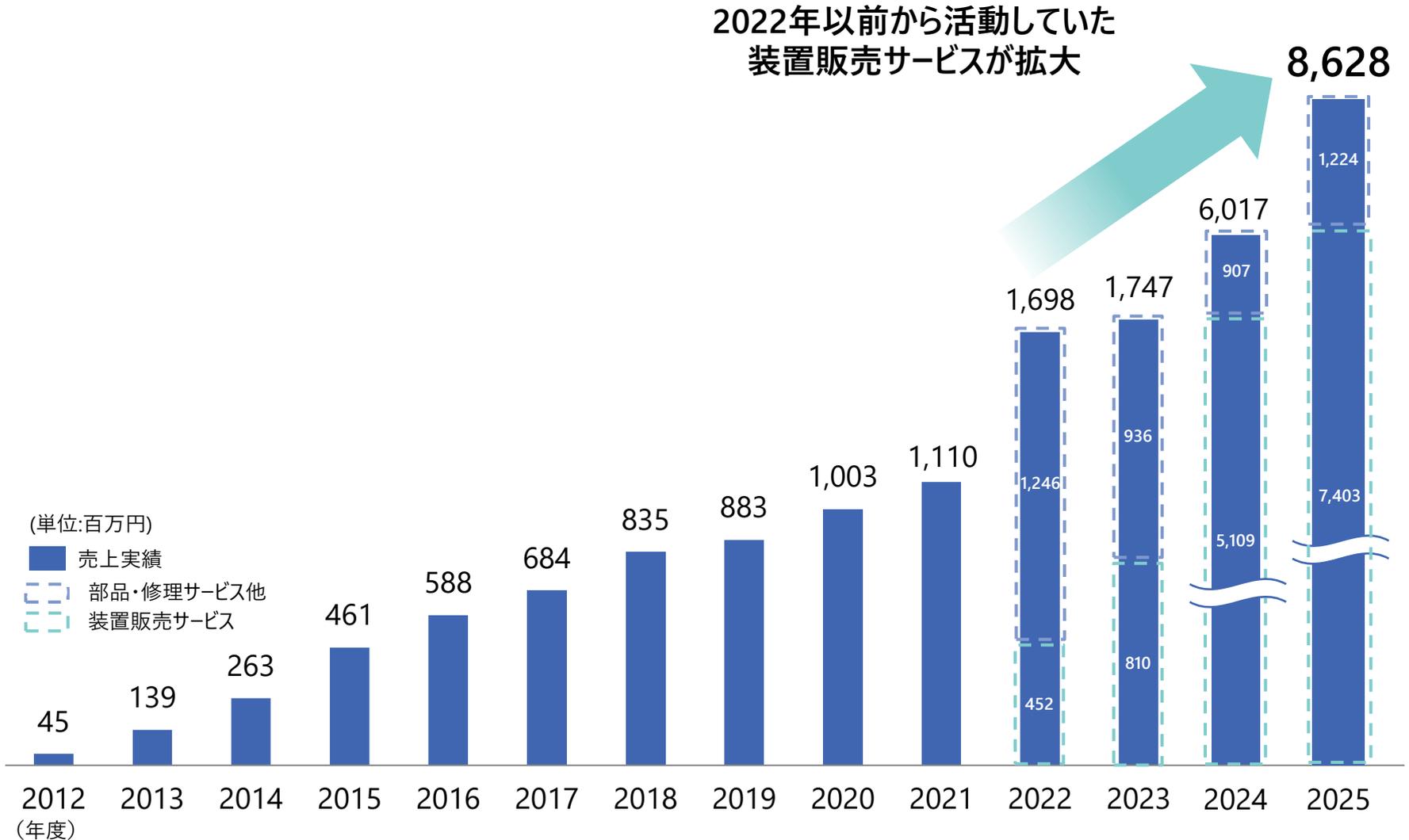


主な取引実績

- キオクシア
- テキサスインスツルメンツ
- ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング
- ルネサスエレクトロニクス
- SUMCOグループ
- 東芝グループ
- ラピス 他

業績推移

プラットフォーム（情報力）とエンジニアリングの強みを融合し、事業は創業以来増収継続



(単位:百万円)

■ 売上実績

▨ 部品・修理サービス他

▤ 装置販売サービス

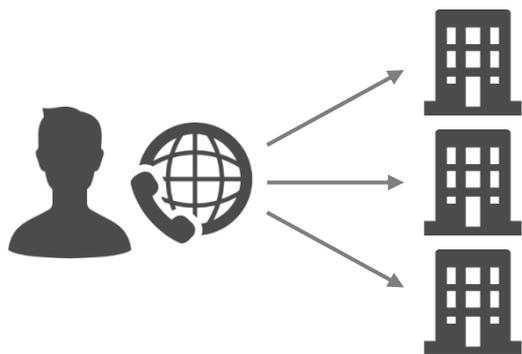
※2024年11月期以前は非連結のため、参考として単体数値を記載しております

LAYLAが提供する価値

世界中の実在庫が可視化できるプラットフォームを確立

- 従来の調達方法では困難だった実在庫の可視化を実現し、
半導体製造装置の調達活動を効率化できるプラットフォームを提供

従来の調達方法



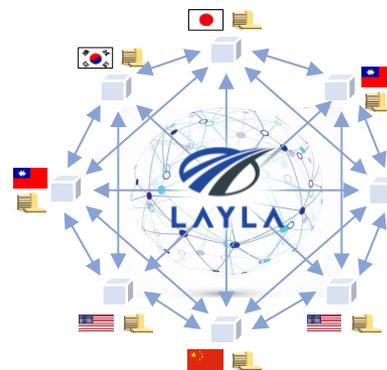
- 調達担当者が、必要な情報を各社に個別で問い合わせなければならないため、**必要な情報が限定される**
- 従来の調達方法では納品まで、**時間、コストがかかりすぎる**
- 調達ルートが限定されてしまうため、**独自に調達ネットワークを確立する必要がある**

老朽化した製造装置の部品調達が困難



LAYLA

商品数**36.9**万点超



世界中の
点在している
部品を集約

- **実在庫を24時間365日確認可能**
- 可視化された実在庫の**価格、納期、保証期間、状態まで確認可能**
- TMHが販売窓口として機能するため、エンドユーザーが安心して購入できる環境を実現(安心保証)

半導体工場のDX化に貢献

ビジネスフロー 装置売買プロセス

装置売買の前提となる解体作業ノウハウが当社にあることが売買加速に

- 装置売買において最も重要となる解体工程を内製化。
高度なエンジニアリング力により迅速かつ信頼性の高い取引を実現



装置解体工程は極めて複雑であり、高度なエンジニアリング力が不可欠

無害化

ガスラインの遮断と排除
冷却液や他の流体の安全
な排除



停止処理

装置からの電源切断
バックアップバッテリーの除
去



配線除去

外部カバーの取り外し
配管やケーブルの取り外し



内部解体

モジュールや部品の個別の
取り外し



分別・廃棄

有害物質の適切な処理
リサイクル廃材の適切処分



テクニカル レポート

作業の詳細な記録
インシデント報告



03 市場環境

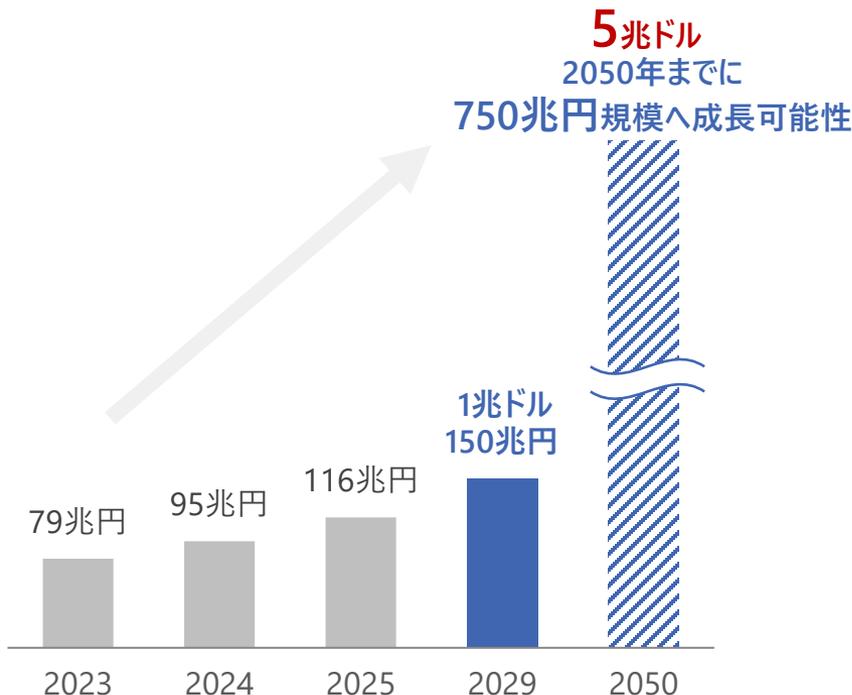
世界の半導体市場規模

150兆円予測を凌駕する市場ポテンシャルの更なる高まりが、当社の成長戦略を後押し

- 世界の半導体市場は、AI需要に関連した投資が牽引し、**2029年までに150兆円（1兆ドル）**まで急拡大の見通し
長期的には、**2050年までに750兆円（5兆ドル）**まで成長する可能性
- 当社が中長期ターゲット市場と見据える半導体製造装置市場についても順調に拡大

世界の半導体市場予測

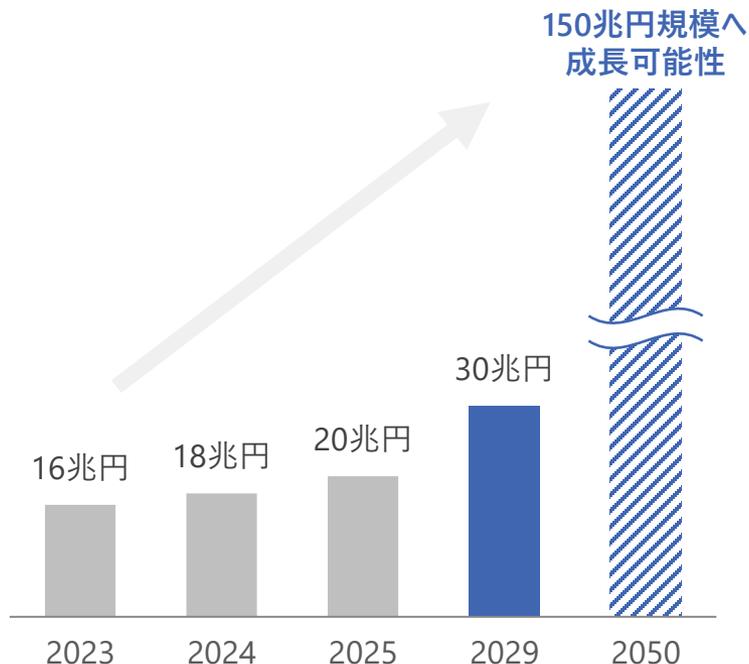
AIに関連し、データセンター投資が牽引
2026年は前年から26%増と予測



出所：(一社)WSTS日本協議会「WSTS 2025年秋季半導体市場予測について」
東京エレクトロン(株) コーポレートサイト「The Future of the Semiconductor Industry and its People」
※150円/USDにて日本円換算後

世界の半導体製造装置市場予測

高性能半導体の需要の増加等を背景に、
先端製造装置を中心に拡大見込む

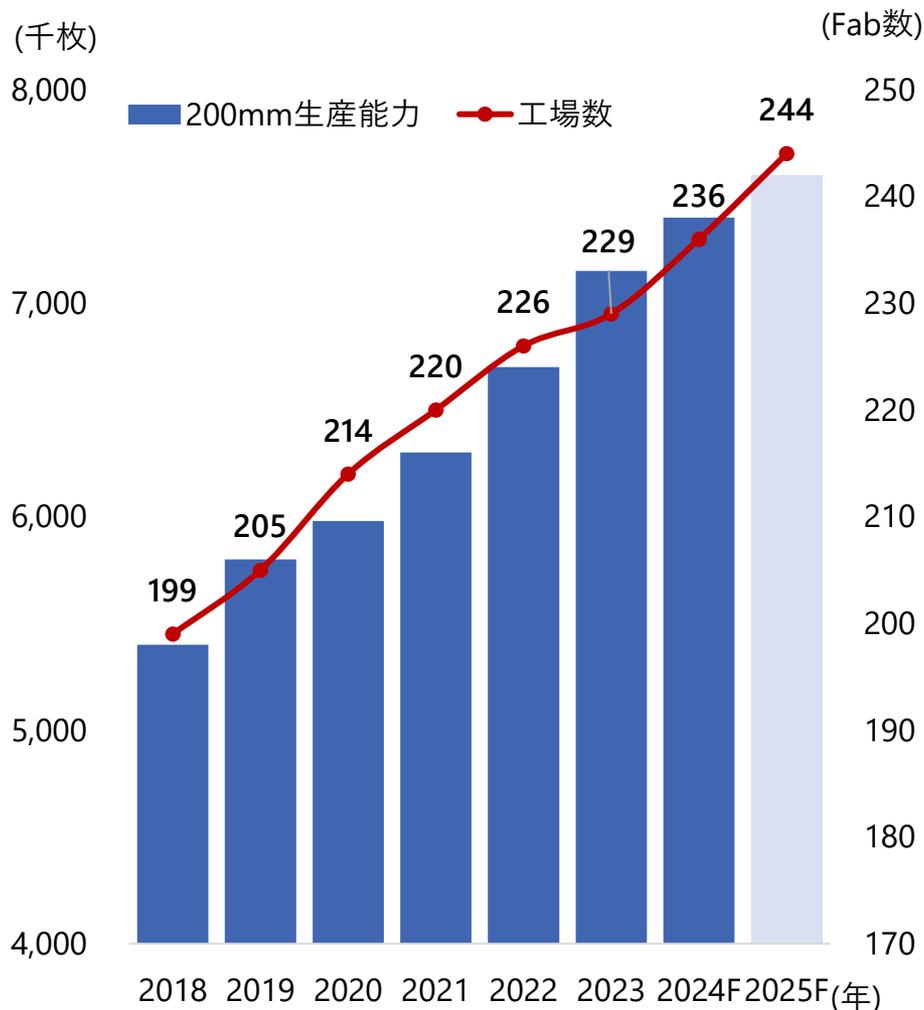


出所：SEMI「世界半導体製造装置の2025年末市場予測発表」を元に試算
2050年は、半導体市場全体の成長率と同水準で推移するものと仮定し算出
※150円/USDにて日本円換算後

レガシー半導体の旺盛

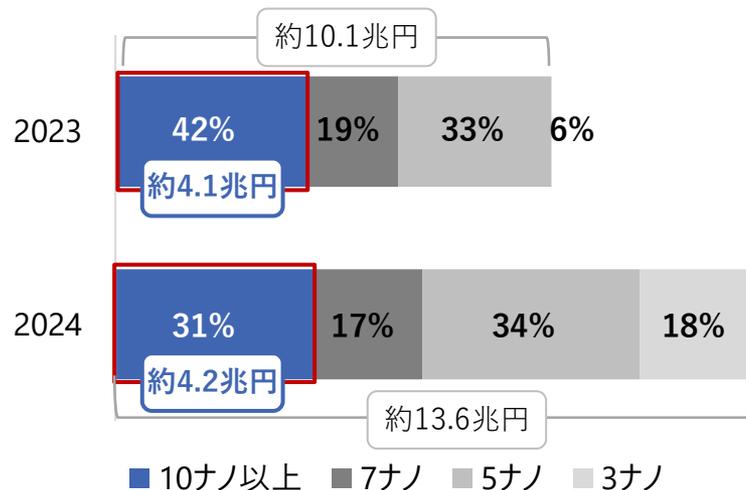
半導体不足により200mm工場の生産能力が急成長へ、先端企業でもレガシー半導体は主力

200mmウエハーファブ数と生産能力推移



TSMCのプロセス別売上構成

10ナノ以上の市場は依然として巨大



2023年：1NTD=4.68円、2024年：1NTD=4.73円
 の為替レートにて日本円の売上高を算出
 2023年：売上高：約2兆1,000億NTD
 2024年：売上高：約2兆8,943億NTD

出所：SEMI 2024年9月25日発行、「世界の200mm半導体前工程ファブにおける生産能力の推移」

出所：TSMC 開示資料より当社作成2023年、2024年通期実績

世界市場における旧型半導体製造装置の重要性

「最先端装置」だけでなく、多様な用途に適応する「旧型装置」の需要も高い

- 最先端工場への投資が活発である一方、旧型半導体に関する需要も依然として高く、

旧型半導体製造装置の保守は、最先端半導体開発と同様に重要なテーマである

市場の現状

投資動向

最先端

生成AI関連の需要旺盛等を背景に、データセンターやスマートフォン等、高性能な最先端半導体の需要は極めて高い状況

国内では官民協力により、TSMC関連投資や、微細化技術の開発など、数兆円規模の投資が進んでいる

国外においても、米国や韓国をはじめ、覇権をめぐる国策としての大規模な投資が活発化

旧型

IoT製品や自動車関連などを中心に、旧型半導体が用いられるパワー半導体やセンサー等の需要は高まる一方

低～中程度の性能の半導体の需要も旺盛。これらを担う**20年以上前に投資された半導体製造装置も現役で稼働**している状態であり、国内で稼働している半導体工場の**8割以上がウエハサイズ200mm以下のレガシー工場**である

旧型半導体製造装置は現在も重要性が高く、例えばインドがレガシー工場を中心として包括的に支援するISMを国策として発足するなど、**装置の保守**（EOL部品の調達、修理、中古装置の購入や立上・改善など）に対する**投資がグローバルでなされている**

< 200mm / 300mmウエハサイズ工場について >

半導体チップを製造する材料であるウエハの直径サイズを意味しております

200mmウエハは、過去に広く使われてきた標準的なサイズですが、現在では生産効率の高いより大きな300mmのウエハが主流になっております
200mmウエハを使っている工場は、古い技術を使っていることが多く、レガシー工場と呼ばれることがあります

ターゲット市場

代理店ビジネスとM&Aにより、ターゲットを20兆円規模の「装置市場全体」へ拡大する

- 既存事業のターゲット市場は、半導体市場のうち、中古半導体装置市場、部品・修理サービス市場である
- 半導体装置代理店ビジネスの開始や、今後見込まれるM&A戦略により、
中長期的には半導体製造装置市場全体をターゲット市場と見据える

現在：2025年

半導体全体市場

116兆円^{*1}

当社の「新規」
ターゲット市場

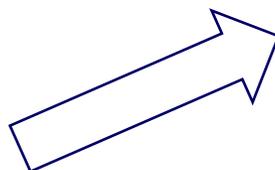
<装置市場全体>

20兆円^{*3}

当社の既存
ターゲット市場

<中古装置販売>
<部品・修理サービス>

4.7兆円^{*4,5}



成長ドライバー

- ・市場全体の成長
- ・代理店ビジネス開始
- ・ホワイトスペースM&A
- ・プラットフォーム拡充
- ・グローバル展開加速

未来：2050年

半導体全体市場

750兆円^{*2}

当社の既存
ターゲット市場

<装置市場全体>

150兆円^{*6}

当社の既存
ターゲット市場

<中古装置販売>
<部品・修理サービス>

23.5兆円^{*6}

*1 出所：(一社)WSTS日本協議会「WSTS 2025年秋季半導体市場予測について」

*3 出所：SEMI「世界半導体製造装置の2025年末市場予測発表」を元に試算

*6 2050年は、半導体市場全体の成長率と同水準で推移するものと仮定し算出

*2 出所：東京エレクトロン(株)コーポレートサイト「The Future of the Semiconductor Industry and its People」

*4 出所：The Business Research Company「中古半導体装置の世界市場レポート 2025年」 *5 半導体製造装置市場の20%と仮定

※150円/USDにて日本円換算

国内半導体工場の現状 半導体工場の新旧比較

国内半導体工場の大半が20年以上前に建てられた200mm以下の工場である

出所：半導体工場ハンドブック2025に基づき作成
前工程 デバイスメーカー拠点単位での集計となります。

西日本

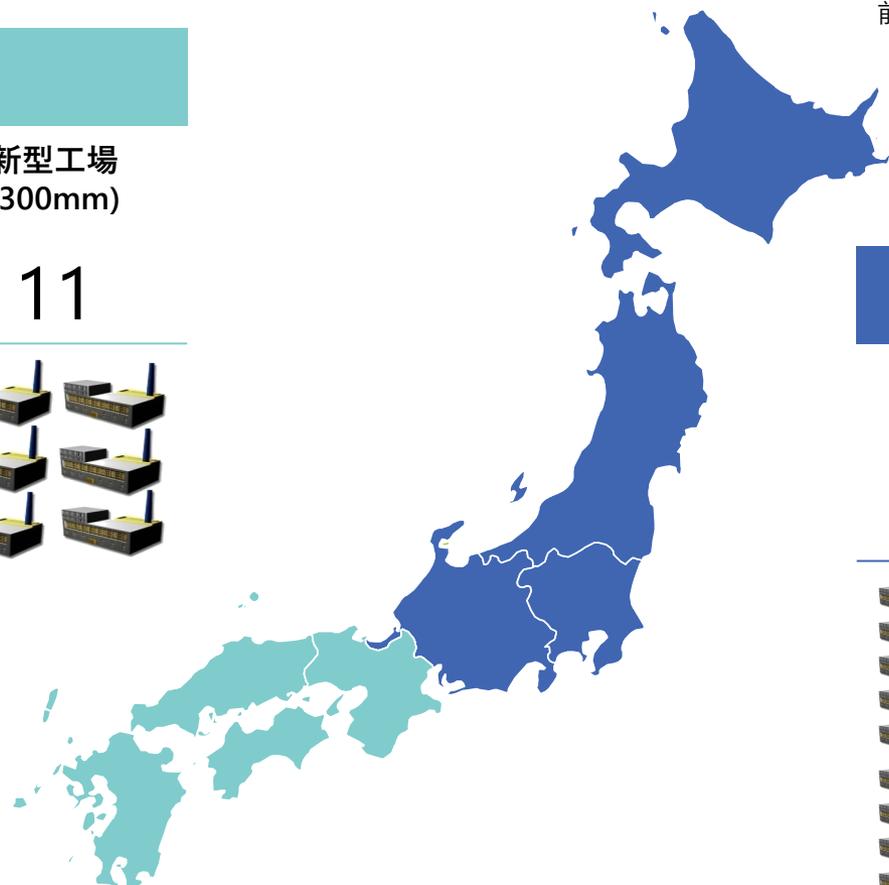
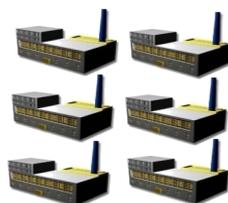
老朽化工場
(200mm以下)

24



新型工場
(300mm)

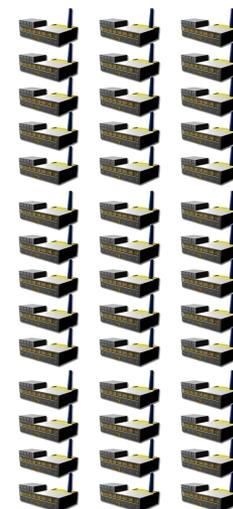
11



東日本

老朽化工場
(200mm以下)

39



新型工場
(300mm)

12



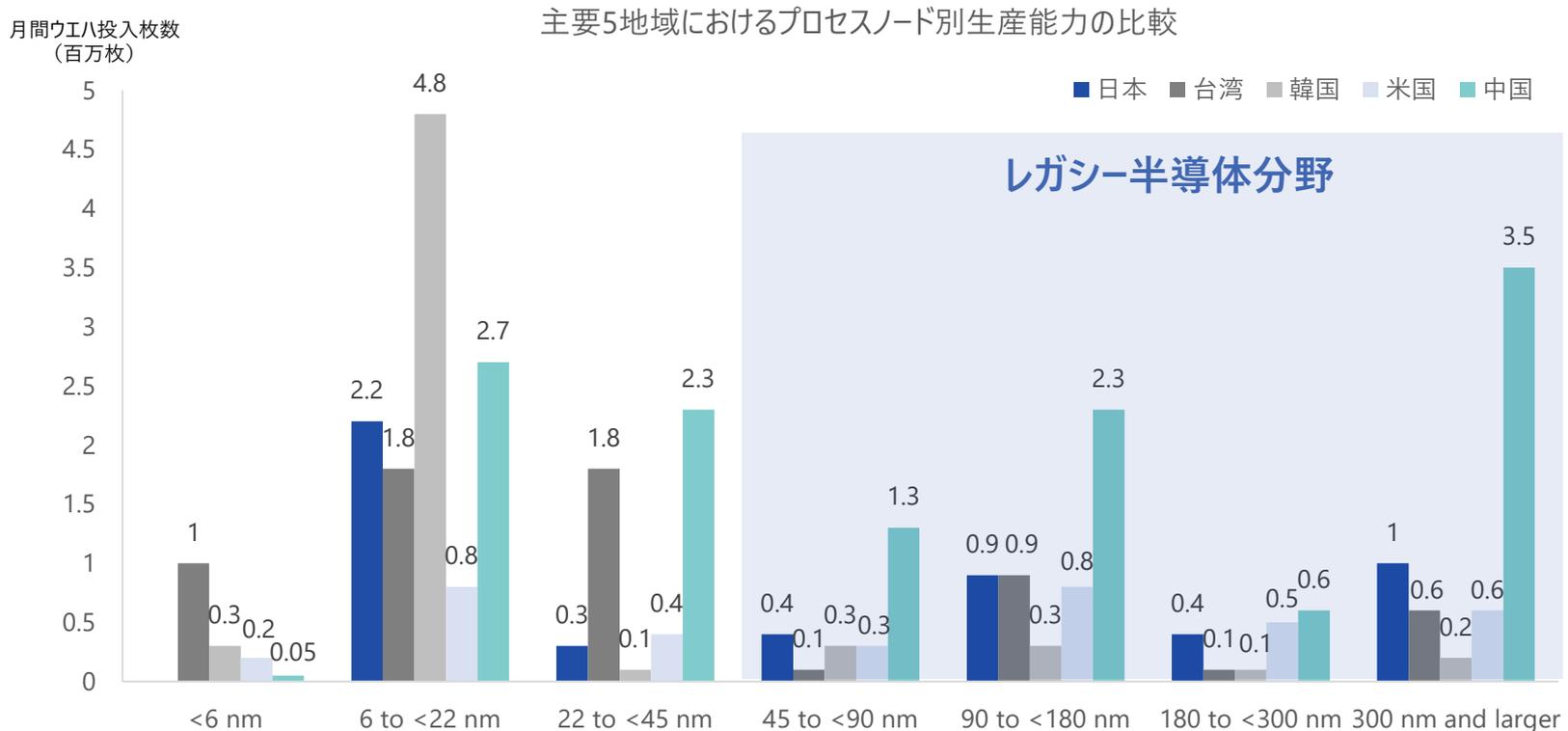
< 200mm / 300mmウエハサイズ工場について >

ミリとは、半導体チップを製造する材料であるウエハの直径サイズを意味しております。
200mmウエハは、過去に広く使われてきた標準的なサイズですが、現在では生産効率の高いより大きな300mmのウエハが主流になっております。200mmウエハを使っている工場は、古い技術を使っていることが多く、レガシー工場と呼ばれることがあります。

レガシー半導体生産の現状

主要地域において、先端半導体だけでなくレガシー半導体の生産も旺盛

- 日本では、JASMの稼働開始により16/12nm、28/22nmプロセスの生産能力を確保した一方、過去から強みとしていた、パワー半導体やイメージセンサー等に用いられるレガシー半導体分野でも、依然高い生産能力を有している
- レガシー分野では中国が生産能力を急拡大させる中、地政学的リスクの側面からも、サプライチェーンにおける日本の価値は高まりをみせている



(出所) OECD「The chip landscape: Geographical distribution of wafer fabrication capacity」(2025年12月) を元に当社作成

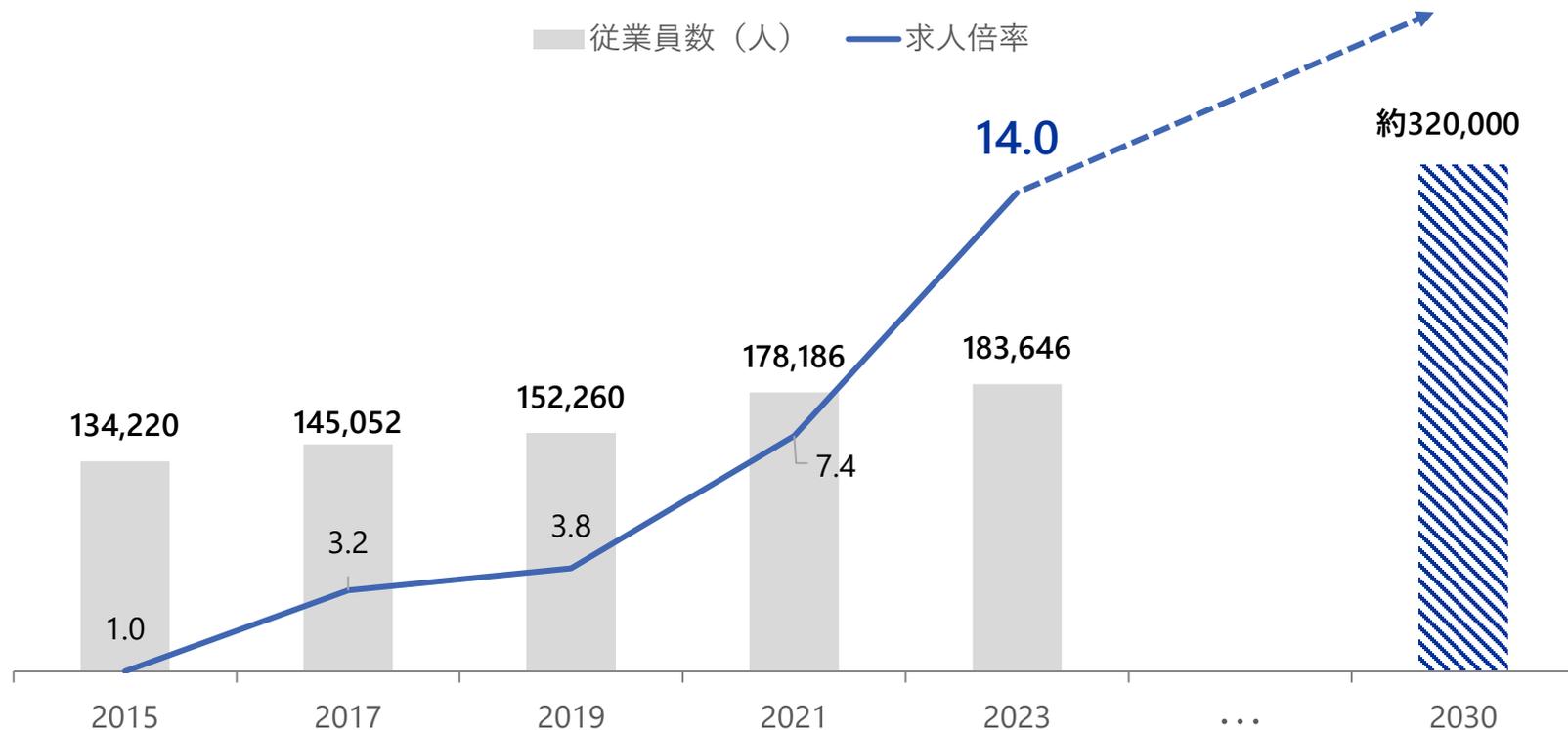
国内半導体工場の現状 半導体業界の人手不足

半導体業界は深刻な人手不足

- 半導体関連産業の人材数は増加傾向にあるが、既に人材が不足している状況であり、求人倍率は著しく上昇
- さらに半導体工場の新規建設等により2030年までに追加で約14万人が必要となるとの見解（SEMI）

人材供給が半導体関連産業のボトルネックとなりうる

半導体関連産業の人材動向およびエンジニア求人倍率



出所：

*1 経済産業省「工業統計調査」、「経済構造実態調査」

*2 日本経済新聞（SEMI幹部「2030年、世界の半導体人材150万人不足」）2024年12月12日記事）

04 競争優位性

当社の価値源泉

①プラットフォーム力及び②エンジニアリング力による製造支援にて価値創出を実現



従来のサプライチェーン課題

老朽化装置の部品不足

災害によるサプライチェーンの寸断

不要装置の処理

エンジニア等の人材不足

競争力の低下

半導体製造装置の老朽化

製造イノベーション

プラットフォーム力

- 装置・パーツ情報供給情報
- 半導体工場の需要情報
- 半導体製造周辺に関連する新規プラットフォーム構築力

エンジニアリング力

- 装置解体、搬出、設置
- 生産性改善提案
- プロセスチューニング

TMHの提供する価値

越境EC：調達ルート確保

部品の修理、調達

半導体人材プラットフォーム提供

装置解体/輸出

装置立上/改善

最終製品の機能改善

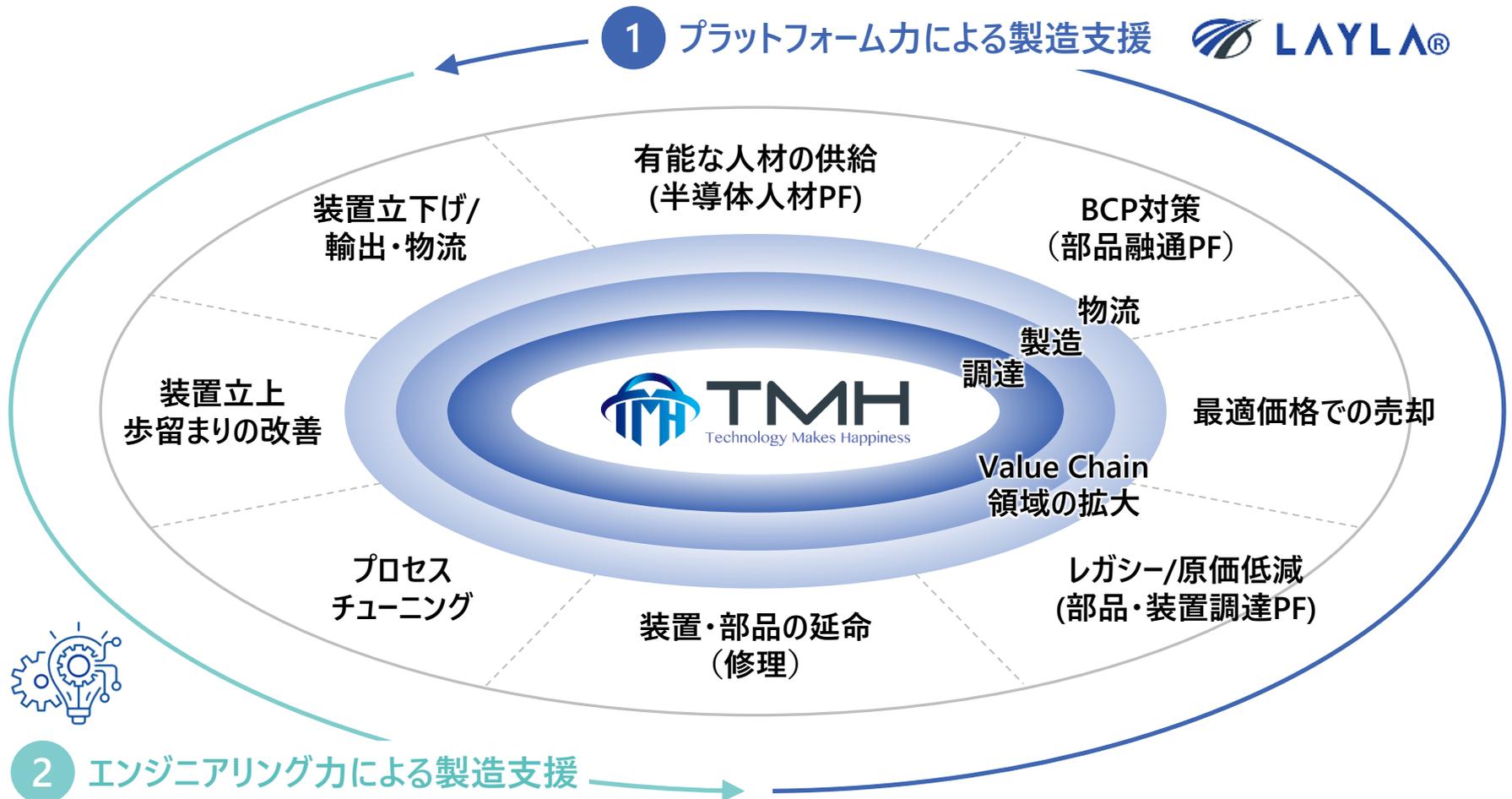
①エンジニアリング力 × ②プラットフォーム力により、顧客の様々な課題を解決

企業の収益向上と価値創出を実現

技術・知識ナレッジの蓄積

半導体工場の多様な課題に対応することで、顧客にとっての唯一無二の存在に

- 半導体工場の課題解決を通じて様々な案件に触れることにより、ノウハウや課題解決力が向上
- 半導体製造に関わる情報集約型企业として安定的な成長へ



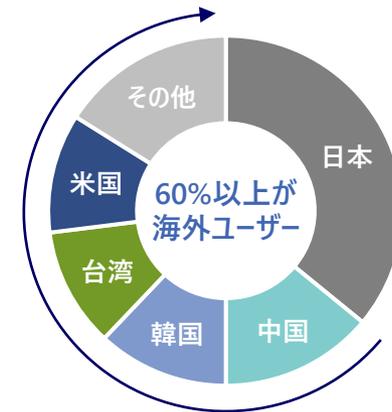
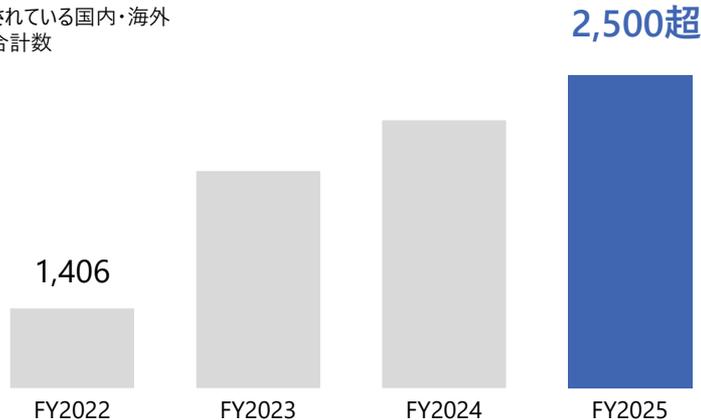
プラットフォーム力

LAYLAは半導体業界に不可欠なプラットフォームへ

- LAYLA-ECは、半導体工場にとって重大な課題となっていた部品調達等を解決するプラットフォームとして、グローバルに拡大を続ける
- 国内においても半導体工場の**50%超がLAYLA-ECを導入済み**。国内半導体製造における重要な役割を担う

グローバルに拡大を広げるユーザー基盤

ユーザーは、LAYLAに登録されている国内・海外全ての購入者・販売者の合計数



LAYLA-ECがユーザーへ提供するプラットフォーム価値

グローバルに広がる調達手段

多言語対応、越境決済、貿易手続等、複雑な越境取引をLAYLA-ECにより容易化

従来調達方法では困難であった越境調達が可能

埋没在庫の可視化

LAYLA-ECを使用することで、世界中の工場に点在する“埋没”している部品等を可視化

レガシー工場にとって最も有効な調達手段として確立

×エンジニアリング力

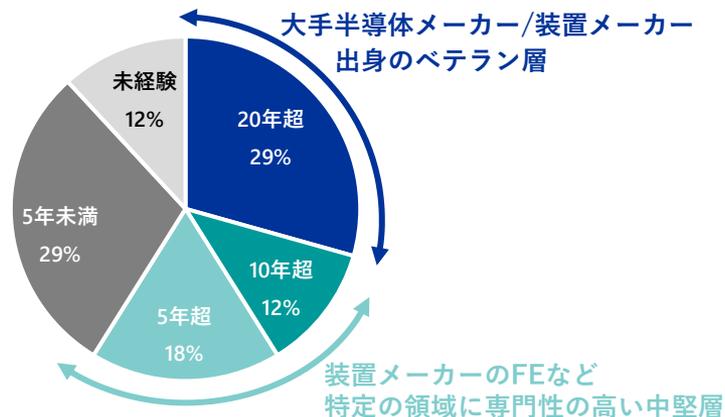
部品等の流通のみではなく、代替品の発掘（目利き）や監査による品質を維持

単なる部品調達ECに留まらないサービスの提供

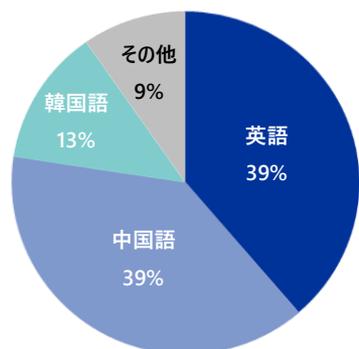
エンジニアリング力 グローバルで評価される専門家チーム

- 半導体分野のプロフェッショナルが厚く在籍。また、半導体分野の主要各国の言語能力も有し、現地の商慣習にも精通したメンバーを揃えている。
- 調達から立ち上げ、延命、改善まで技術的課題の解決に一气通貫して対応できるエンジニアリング力を発揮
世界最大の半導体メーカーからサプライヤーアワードを受賞するなど、グローバルから評価

経験豊富かつ市場に希少なベテラン・中堅層



半導体主要各国に関する言語能力



出所：2025年11月末時点（管理部門を除く）

フィールドエンジニアリング

中古半導体装置の販売を行うのみでなく、解体、搬出（設置）およびプロセスチューニング（装置の最適化）等、「レガシー装置」に熟知したベテラン・中堅エンジニアが、生産性改善から稼働延命まで一气通貫で支援。

ノウハウの複利効果

グローバルに広がるLAYLAプラットフォームにより、世界中の知見、商慣習、情報を集約。経験豊富なエンジニアとのシナジーにより、競合他社には模倣が困難なエンジニアリング力を実現。

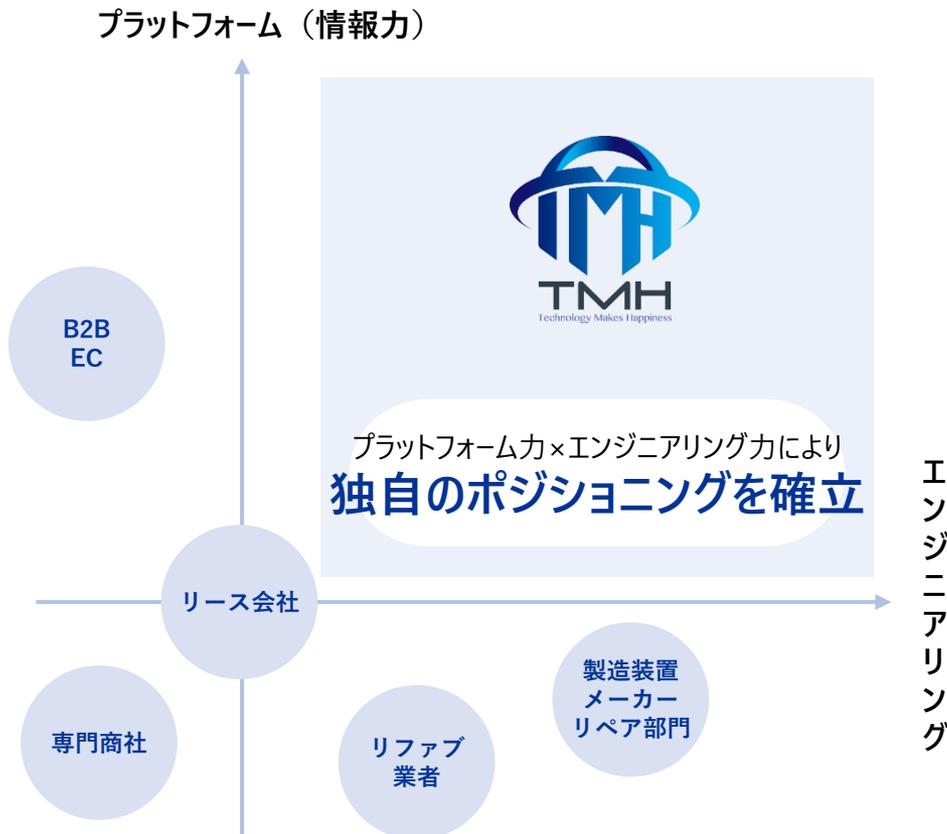
目利き力

半導体工場が調達困難な部品等であっても、代替品の可能性や海外も含めてソーシング対応。品質を判断する目利き力により「購入してみたものの期待通りに機能しない」といった、中古部品等の重大リスクを最小限に削減。

ポジショニングマップ

独自のポジショニングを確立し、ニッチトッププレイヤーとしての市場を創造

競合と当社のポジショニング比較



当社の優位性・参入障壁

01 | エンジニアカによる高付加価値 vs リース会社、商社

- プラットフォームを活用した情報力、高度なエンジニアリング力に基づく知見を有する
- 半導体製造装置の立上げやプロセスチューニングといった高度な支援を提供

02 | レガシー工場、マルチベンダー対応 vs 半導体製造装置メーカー

- 装置メーカーは先端工場に対して支援が厚いが、当社はレガシー工場も含めて広く半導体工場を支援
- 装置メーカーは自社製品を中心に取扱うが、当社は全ての製造装置メーカーの商材を扱い、幅広いサービスラインナップを提供

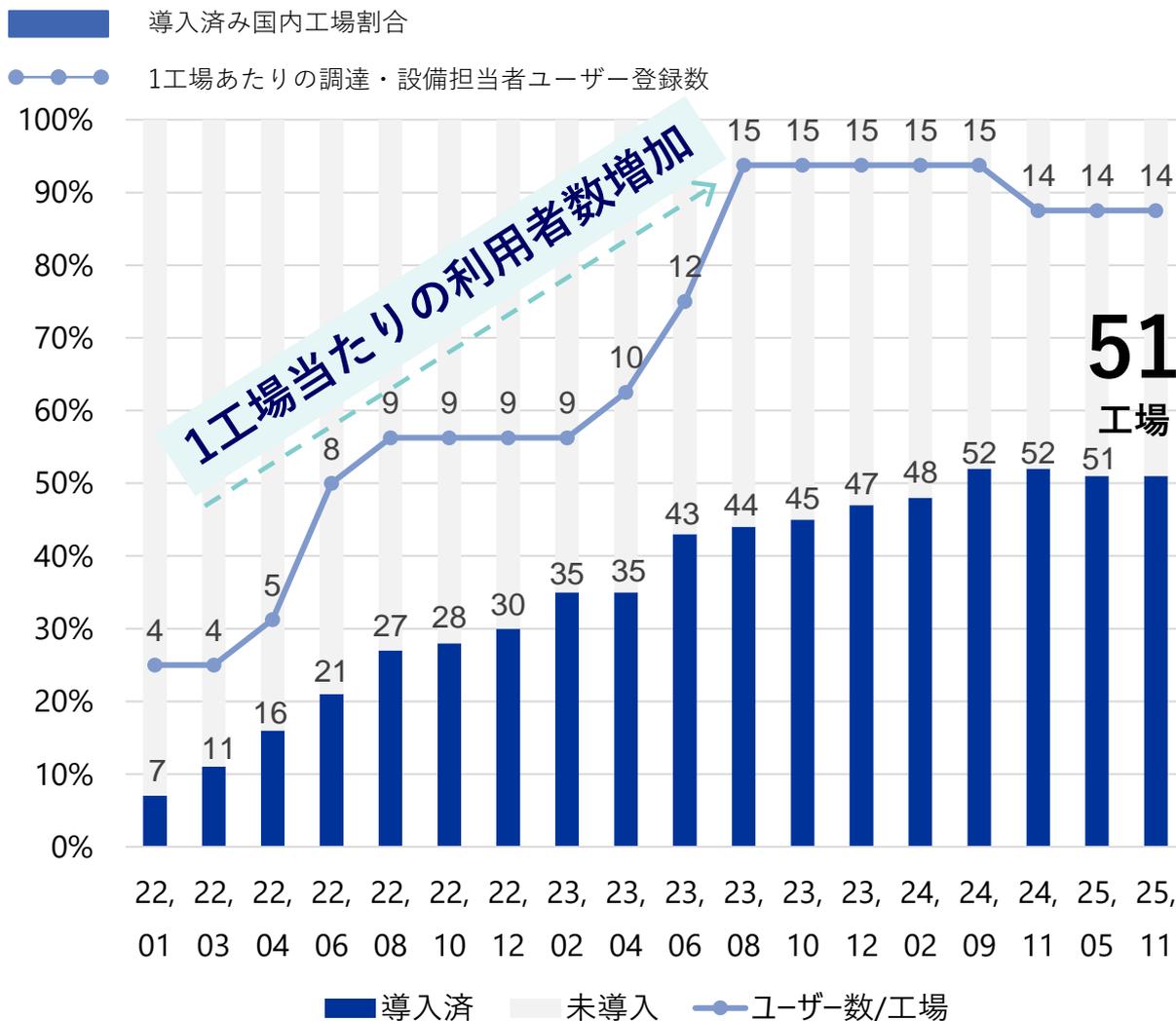
03 | 強固な顧客基盤 vs 新規参入

- 半導体製造領域は技術的な知見を必要とし、また当社は、既に日本全国に顧客基盤があり多くのシェアを獲得していることから、参入障壁を高く保持することが可能

①×②急速に拡大する強固な顧客基盤

国内半導体工場へのLAYLA-ECの導入が加速し、多数の調達・設備専門家が登録

国内半導体工場登録数・国内半導体工場ユーザー登録数推移



国内登録工場数(2025 11月末)：
51工場/約100
 (導入率50%超)

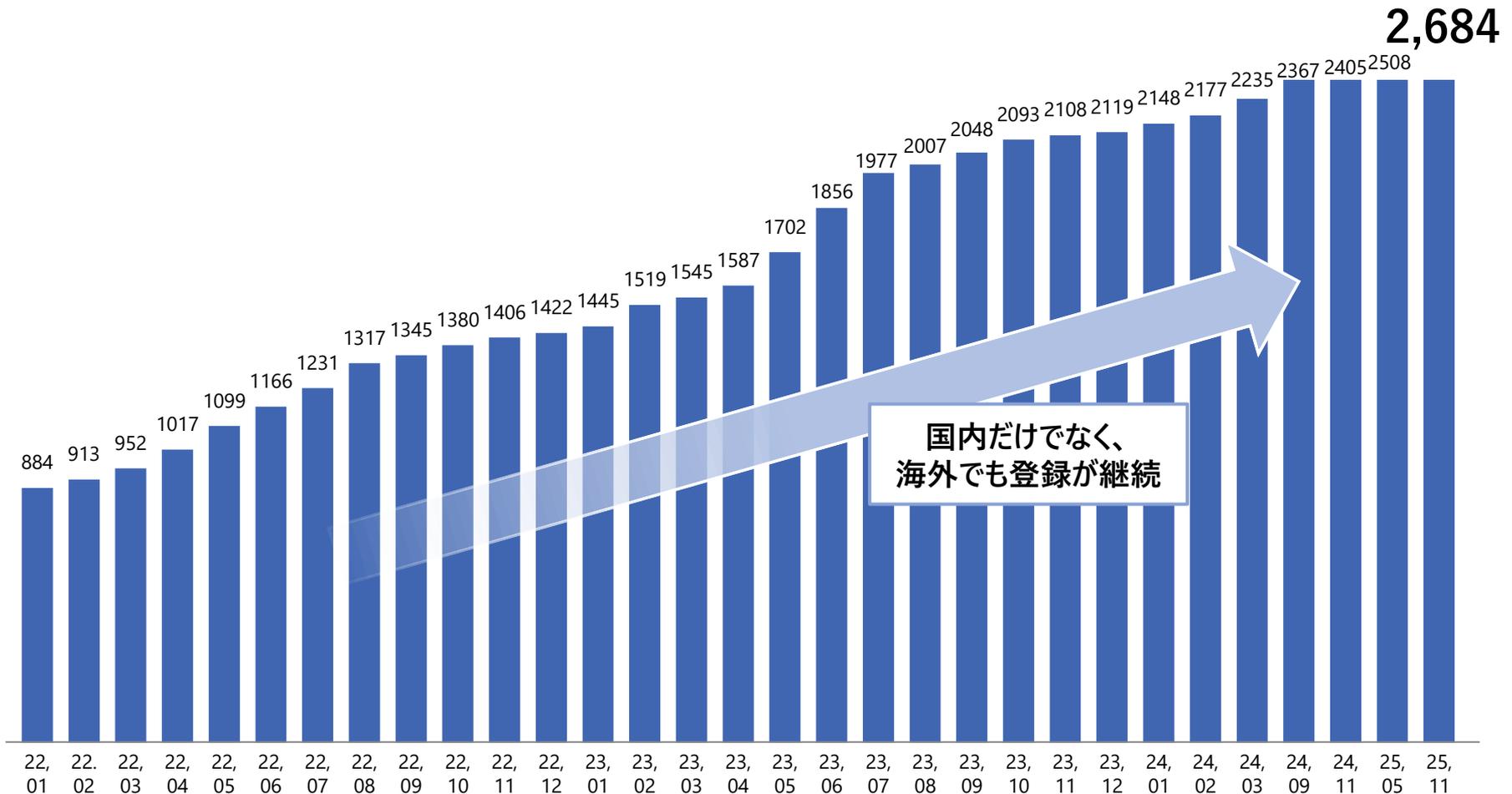
商品点数(2025 11月末)：
36.9万点超

1工場あたりの調達・設備担当
 ユーザー数(2025 11月末)：
14人/工場

国内登録工場数は工場数を意味しております。そのため、同じメーカーでも、工場拠点が異なればそれぞれ別でカウントしております。

①×②継続的に成長するLAYLA-ECのグローバルユーザー LAYLA-ECのグローバルユーザー数も安定的に拡大

グローバルユーザー登録数推移



国内だけでなく、
海外でも登録が継続

グローバルユーザーとは、LAYLAに登録されている国内・海外全ての購入者・販売者の合計数

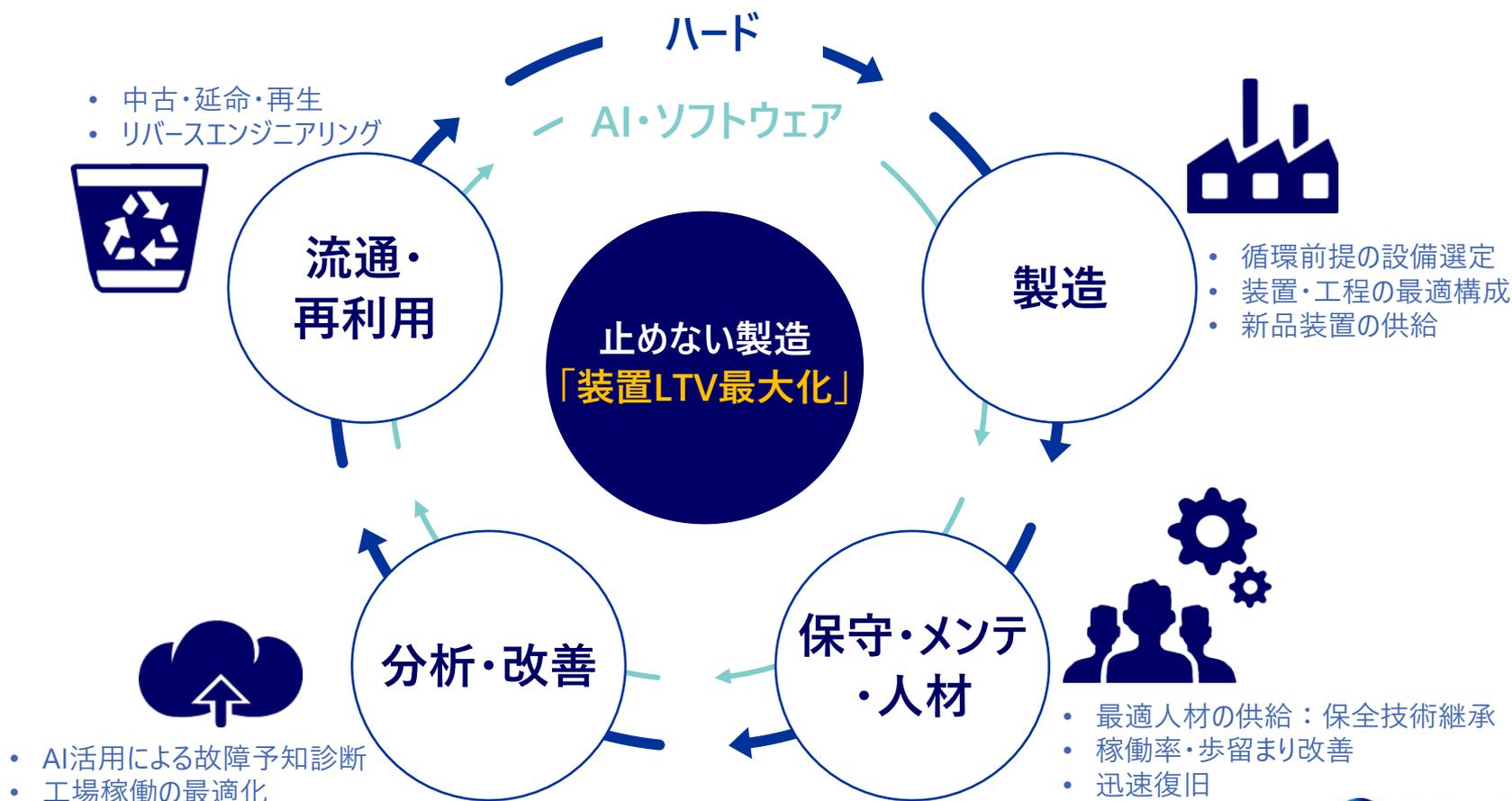
05 成長戦略

当社の考える 未来の半導体製造サプライチェーン

「循環型」ビジネスを前提とした、効率性の高いサプライチェーンが重視されるモデルへ

- 資源枯渇、紛争・分断など不確定要素が高まる社会では、「**止めない製造**」を実現するための**循環設計**が重要視
- 「故障予知により稼働を止めない」、「稼働率・歩留まり・人材定着まで含めた価値提供」、新品前提から「循環型」へ

循環設計



中長期目標 Vision1000

当社は、中長期的に売上高1000億円規模の企業体への成長を目指す

TMHは、アフターサービスを担う装置ライフサイクルサポートから、仕組みとシステムによるプラットフォームを通じて半導体製造を統合的に支援する「半導体製造インテグレーター」へと進化する

Vision1000

半導体製造インテグレーターへ
工場の多様な課題を**エンジニアリング**×**プラットフォーム**により解決

半導体製造装置の供給・保守、フィールドサポート (装置供給による製造× エンジニアリング)	製造	サービス : 工場全体の運営受託、生産性改善・コスト最適化の請負契約 収益モデル : 工場運営全体の包括契約、高付加価値モデル
工場DX推進・AI活用による保全効率化 (ソフトウェアによるシステム プラットフォーム)	DX・AI予知保全	サービス : DX推進/AI活用により、半導体工場のレガシーシステムの改善・刷新 収益モデル : SaaSモデル、ソフトウェア利益率による高収益化
材料供給・ファシリティ運営・工事 (設備基盤× エンジニアリング)	材料供給 ファシリティ管理 工事	サービス : 薬液・ガス供給の安定運用、純水・空調・廃棄処理など工場インフラ管理、工事 収益モデル : ストック型収益 + 高収益率
人材・オペレーションサポート (人材 プラットフォーム)	人材・ オペレーションサポート	サービス : 人材プラットフォームサービス、エンジニア教育・研修プログラム 収益モデル : 継続契約化 (準ストック型)
装置ライフサイクルサポート (越境EC プラットフォーム 等)	装置ライフサイクル サポート	サービス : 越境ECを活用した部品販売・修理サービス、エンジニアリング力を活かした装置販売、その他付帯エンジニアリングサービス 収益モデル : 単発取引あり、一部準ストック型

ホワイトスペースを埋めていくことが、半導体工場の稼働継続に必要な要件を充足

「止めない製造」の実現へ

Vision1000 ロードマップ

アフターサービス企業から“半導体製造インテグレーター”へ！売上高1,000億円へのロードマップ

オーガニック成長を加速させるとともに、インオーガニック成長への施策に取り組み、Vision1000の達成へ

~2025年11月期

2026年11月期~2028年11月期

203X年

Phase 1

売上高 86億円
営業利益 3億円

半導体工場の ライフサイクルサポート事業確立

- ・ LAYLA顧客基盤の確立
- ・ 装置販売サービスの拡大
- ・ プラットフォーム力、エンジニアリング力の強み確立

Phase 2

売上高* 180億円
営業利益 17億円

①代理店ビジネス開始

代理店事業等、既存の強みを活かした周辺事業の開拓

②ホワイトスペースM&A

半導体分野におけるホワイトスペースへの能動的M&A

③プラットフォーム拡充

LAYLA-HR、SEMICON.TODAY等、プラットフォームの拡充

④グローバル展開加速

海外投資による販売・調達ルートの拡大

中期
180

Phase 3

売上高* 1,000億円
営業利益 150億円

Vision
1000

中期施策を磨き上げ、
オーガニック×インオーガニック
で更なる成長へ！

*売上高については流通総額の情報として記載しております。

①装置代理店ビジネス

エンジニアカによる高収益事業サイクルの確立

エンジニアリング力を活かし、大手半導体装置メーカーの代理店事業を開始
当社の強みを活かし、**高収益かつ既存事業とのシナジーによる成長を図る**

事業特性（提供価値、シナジー）



戦略的意義

継続的な高い収益貢献

装置メーカーの代理店は単なる仲介ではなく、導入支援、サポート等の技術的背景が求められるため、高い利益率を獲得可能

また、一度導入された装置は継続発注されるため、継続的な装置売上・アフターサービスへ

エンジニアリング力強化

先端装置の取扱により、最新技術・ノウハウの獲得に寄与。既存事業との技術的シナジーを獲得

信頼性の向上

当事業は国内外への自社の高い技術力を証明し、当社の信頼性を向上させる側面を有し、競合優位性が向上

結果として、次なる半導体製造装置メーカーの代理店への道も

②ホワイトスペースM&A M&A実行プロセスとケイパビリティ 自社専門チームを整備し、能動的にM&Aの実施を推進

- M&Aに関するケイパビリティを確保し、M&Aの各プロセスに応じた専門チームを整備済み

M&A実行プロセスと、整備済みの自社ケイパビリティ

共通指針

Step1 ソーシング・戦略検討

公開情報のみでなく、自社の独自情報を活用し、事業特性や既存事業のシナジー等を検討

<ソーシングチーム>

経営企画室を中心とし、定期的に選定候補を評価・検討する会議体を設置
公認会計士・US CPAチーム



Step2 評価・フィルタリング

投資リターン、投資金額の適切性評価、財務健全性評価を行う

<財務・法務DDチーム>

CFO、公認会計士・US CPA、法務担当メンバー等
+外部専門家の活用



Step3 実行・PMI

調査結果に基づき、候補先の事業性等を総合的に吟味し、最終ターゲット決定

統合プロセスを実行も
自社で完遂

<PMI推進チーム>

CFO、公認会計士・US CPA等



・成長の加速

オーガニック成長に加えてM&Aを活用することで、中長期ビジョンの達成スピードの加速

・戦略的合理性

既存事業とのシナジーが期待できる事業に注力し、非連続的な価値創出を図る

・規律ある投資の徹底

投資リターンが資本コストを上回り、株主価値を向上させる案件のみに投資

・適切なPMIの徹底

合理的な統合計画により、投資リターンの確実性を高める

・財務健全性の維持

適切なM&A実行プロセスにより成長性と安定性の両立を図り、株主価値向上を目指す

②ホワイトスペースM&A M&A候補のソーシング/フィルタリング体制 専門性を活かし、M&Aを優位に進める

- TMHでは候補先の絞り込み段階から内製化し、ソーシングから、プレディール以降においても能動的かつ優位にM&Aを実行することが可能となる体制を構築

潤沢な独自情報に基づくソーシング・プール

独自の業界知見等に基づく
ダイレクトアプローチ

公開情報、
M&A業者等

初期ソーシング・プール

公開情報のみならず、自社プラットフォームや既存事業で得た独自情報に基づき調査

フィルター1：戦略的基準

プロダクト、市場の既存事業とのシナジーをはじめ、文化適合性や経営資源を総合的に検討

フィルター2：財務的基準

投資リターンおよび投資金額の適切評価、財務健全性等を検討

最終ターゲット

TMHソーシングモデルの優位性

能動的かつ独自のルート

- M&A市場に出回らない優良企業の独自情報
- 候補先との1on1のディールであり、入札案件等と比較し交渉に優位
- 仲介業者等を介さないことによる投資コストの低減

業界・専門性への深い知見

- ソーシングフェーズから、候補先の事業性、既存事業とのシナジーを適切に評価
- M&A実施後の適切な戦略検討を見据えた候補先選定

内製化プロセス

- 大手プロフェッショナルファーム出身者や公認会計士・USCPA、M&A業務経験者などが自社M&Aチームに参加し、ソーシング段階から一定の財務的評価、適切な価格目線の設定が可能
- プレディール以降においても、連続的な検討が可能
- 外部専門家に要する費用も最小限であり投資コスト低減

②ホワイトスペースM&A M&A戦略の位置づけ・方針

ホワイトスペースの開拓に注力し、既存事業とのシナジーを最大化

- M&Aにより「ホワイトスペース」開拓のスピードを高め、**半導体工場の“半導体製造インテグレーター”へ進化**する
- 既に自社内に専門チームを立ち上げており、公開情報のみならず、自社プラットフォームで入手した独自情報に基づき検討を推進中

M&A戦略の位置づけ

		プロダクト・サービス	
		既存	新規
市場	既存	市場浸透戦略 既存製品×既存市場	新製品開発戦略 新規製品×既存市場
	新規	新市場開拓戦略 既存製品×新規市場	多角化戦略 新規製品×新規市場

対象候補の例

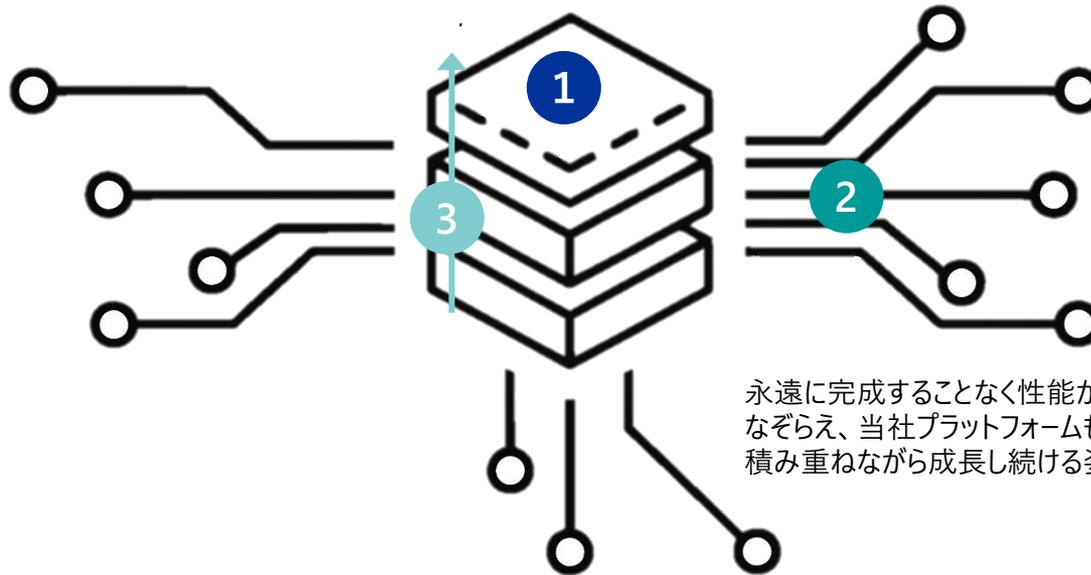
	M&Aの目的	候補領域	優先度
1	事業統合 <ホワイトスペースの開拓>	・材料供給系 ・ファシリティ系 ・工事系 ・人材系（教育・研修） ・ソフトウェア系（SIer） ・メーカー機能（部品・エンジニアリング） ...etc	高
2	機能統合	部品供給・メンテナンス、装置エンジニアリング領域	中
3	市場拡大	物流領域等	低

③プラットフォームの拡充 TMHの成長と戦略

LAYLA-ECの「モノ」に加え、人・情報を軸としたプラットフォームを拡張し、半導体産業の成長を後押し

プラットフォームの未来像

半導体製造の「人」、「モノ」、「情報」のプラットフォーム化が新たな付加価値を生み出す



永遠に完成することなく性能が進化し続ける半導体チップになぞらえ、当社プラットフォームもまた、「人」「モノ」「情報」を積み重ねながら成長し続ける姿を表しています

①LAYLA-EC「モノ」 安定収益基盤の拡張

半導体が“動き続けるための物理層”：
(前提条件)

商品点数の拡充、顧客深耕により、継続的な売上拡大・利益の積層を実現することで当社利益の土台へと成長

②LAYLA-HR「人」 成長エンジンの多層化 SaaS型領域へ

半導体の配線、回路のように
価値を生む“機能”そのもの

技術世代の変化に伴う人材需要を捉え、高度・専門領域へと展開することで付加価値と収益機会を拡大

③SEMICON.TODAY「情報」 非連続成長の創出

各レイヤーがどう接続されるべきかを
共有する設計思想・情報層

情報の積層と拡張により、新たな事業機会・連携・価値創出を生み出す成長基盤へと進化

③プラットフォームの拡充 成長ポテンシャル

安定収益基盤の拡張に加え、新たな収益ポートフォリオへの展開や既存事業とのシナジーを見込む

①LAYLA-EC「モノ」 安定収益基盤の拡張

半導体工場の調達インフラの一つへ
- 商品ラインナップの拡充・顧客深耕により、修理・部品調達の半導体工場のワンストップ調達基盤へ

類似高付加価値装置産業への展開

- 半導体工場で培ったECプラットフォームのノウハウを活かし、医療機器など高信頼性が求められる装置産業へ横展開

②LAYLA-HR「人」 成長エンジンの多層化 SaaS型領域へ

当社に適合する有能な人材は
オーガニックグロスへ
- 競合激しい人材獲得を独自プラットフォームで確保
- 中長期戦略を見据えたバックキャスト採用

BtoB SaaS型プラットフォームとして 専門性で差別化された収益

- 人材需給のひっ迫が続く中で、企業・エージェント双方が人材探索プラットフォームとして利用拡大、安定的かつスケラブルな収益源へ

③SEMICON.TODAY「情報」 非連続成長の創出

CXO層を起点とした事業シナジー
- トップレベルでの事業提携
- 実務者レベルでの既存事業との連携

B2B専門メディアとしての自立収益

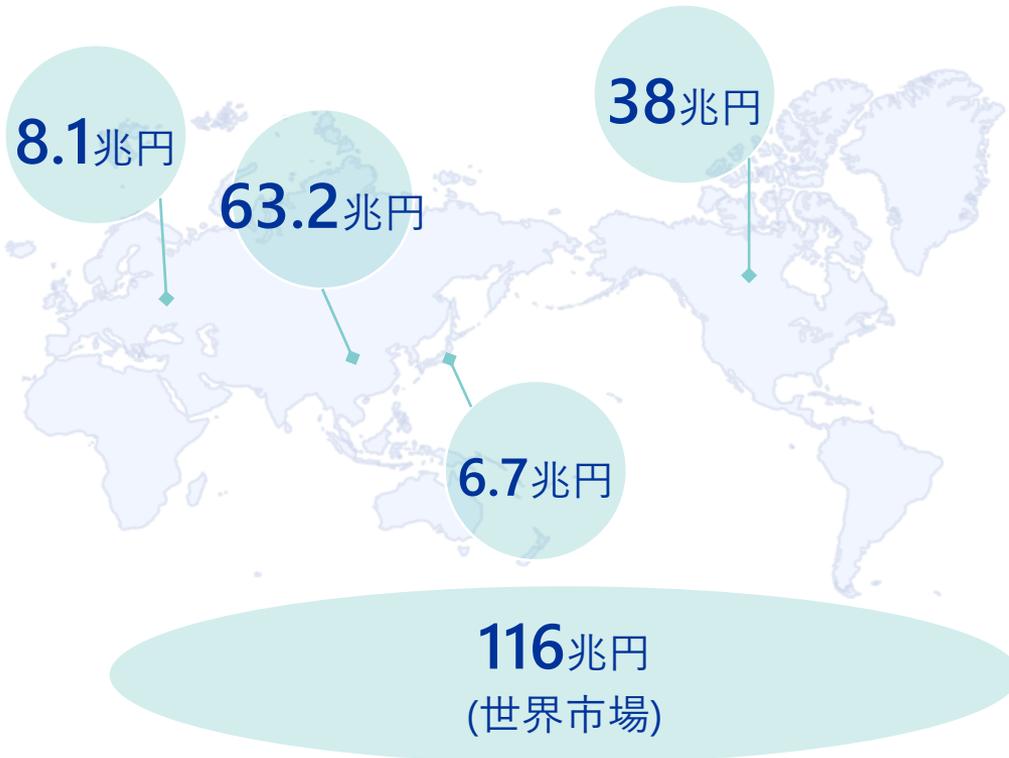
- 広告収益（タイアップ含む）
- 有料会員やサブスクリプション
- B2Bイベント・ウェビナー 等

④グローバル展開加速 事業販路の拡大 ～中長期計画 海外展開～
装置延命のトータルソリューションノウハウを活かし、海外展開し売上拡大を図る

国内のトータルソリューションにより培ったノウハウを、海外に展開
2025年の海外進出を皮切りに、世界規模での躍進を目指す

2025年の半導体市場予測

海外展開ポテンシャル



韓国	DRAMやNANDフラッシュなどの特定の製品に特化しているため最先端装置が中心。装置売却ニーズは恒常的に発生
インド	インドの半導体市場は政府と民間企業の協力による投資が進行中で、大きな成長を遂げている。投資する技術レベルからも中古装置購入やメンテナンス需要が拡大が見込まれる
中国	中国は半導体の技術進化に取り組んでおり、最先端技術の追求と共に旧世代の技術や装置を用いる工場への投資継続
米国	多くの米国企業が製造をアジアにアウトソーシングしているため、国内の製造能力や技術力の維持・強化が課題
台湾	世界的な半導体製造のリーダーとしての地位を維持するための競争が激しく、旧世代の工場も効率的な運用が必要
欧州	他の地域に比べて最先端の半導体技術の研究開発が遅れており、旧世代の工場に依存する部分が多い

(出所) World Semiconductor Trade Statistics / 世界半導体市場統計

④グローバル展開加速 事業販路の拡大 ～中長期計画 海外展開の進捗状況～ 韓国・インド・中国を中心とした海外展開を成長ドライバーとし、柱に事業を強固なものとする

韓国市場を **初の海外子会社** 拠点として設定

世界的シェアを持つ韓国大手半導体メモリーメーカーが実施する装置調達に係る入札への参加体制を構築したことを契機に、半導体製造装置の調達網をグローバルに拡大



子会社拠点の平沢市は、
韓国大手半導体メモリーメーカー工場など
半導体関連工場が集中

潜在力

韓国の半導体市場は政府の積極的な支援と民間投資により、今後も大きな成長が期待。特にAI半導体や次世代メモリ分野での研究開発が進められ、グローバル市場での競争力強化が図られている

戦略

2025年7月15日に韓国平沢市に子会社を設立。韓国における装置調達およびグローバル販売のさらなる拡大を見据え、エンジニアリング力を活かした装置販売の強化ならびに、越境ECプラットフォーム「LAYLA」の展開拡大を狙う

インド市場を **重点営業強化** エリアとして設定



ECを活用した部品販売や修理サービスから、装置販売先の顧客開拓までを日本と連携し対応

潜在力

インドは国策として積極的に半導体製造工場の投資を実施、タタGrと台湾のパワーチップ（PSMC）共同による半導体ファブ建設予定もあり、旧型装置やメンテナンス需要も高い

戦略

2024年にインド顧客開拓を実施。セミコンインディアの出展を皮切りに市場拡大を狙う。中長期的には海外営業拠点の一つとして検討

中国市場を **重点営業強化** エリアとして設定



新事業展開および中古装置販売の強化を検討

潜在力

中国の半導体市場は、巨大な内需とデジタル化の進展を背景に成長余地が大きい。米中摩擦による短期的な制約はあるが、国産化投資が加速し、政策支援の下で中長期的な自立化と市場拡大が期待される

戦略

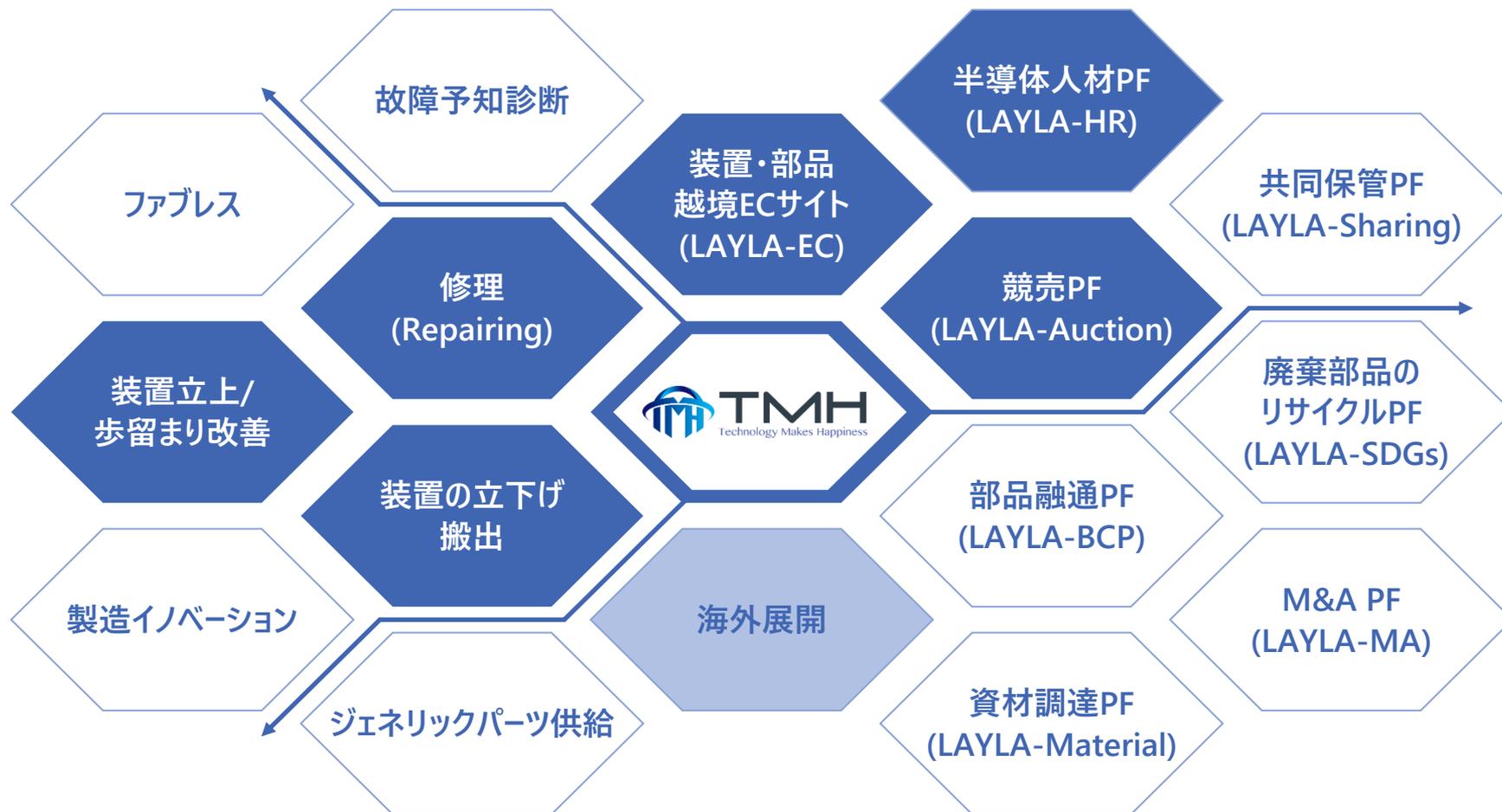
現地企業との共同による新事業立ち上げや、中古装置売買を円滑に促進するための拠点として検討

新規事業の推進 ～当社が目指す成長イメージ～

半導体製造にかかわる課題解決・革新を続ける企業として成長投資を継続

エンジニアリングの拡張

プラットフォームの拡張



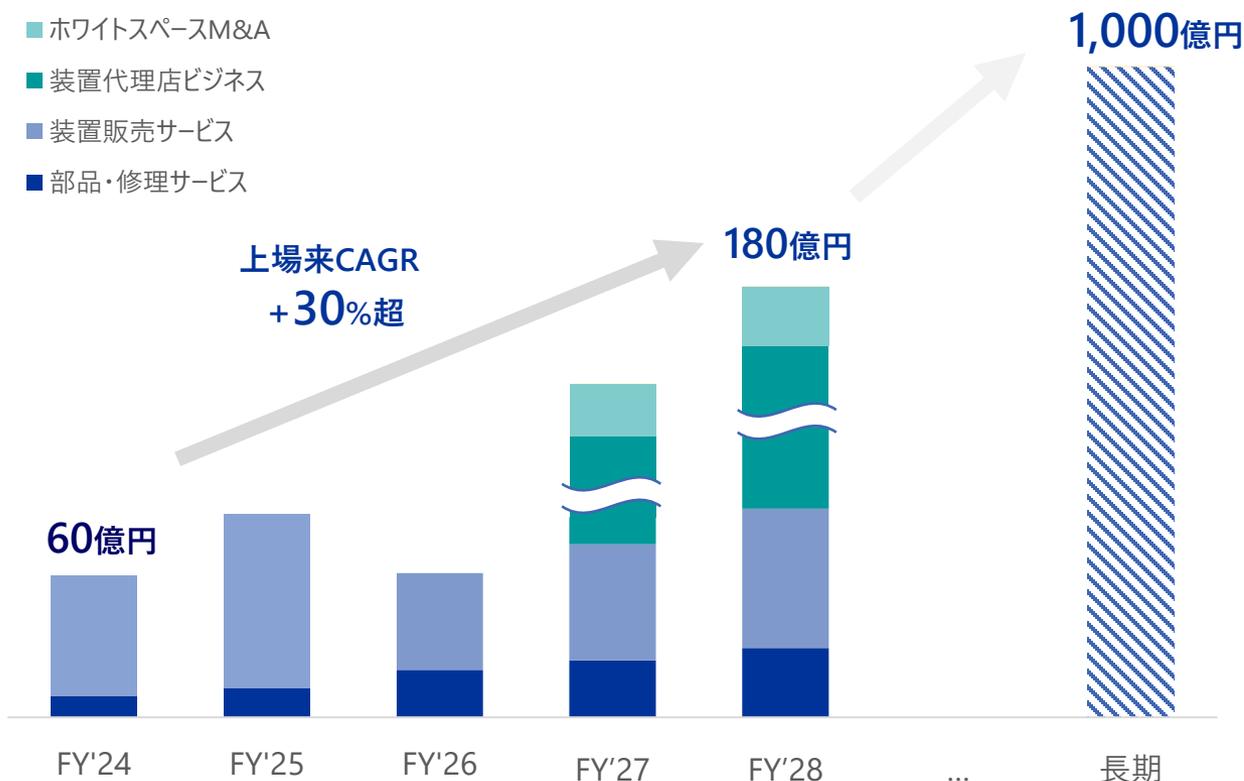
中長期成長イメージ（売上高）

代理店とM&Aでポートフォリオを広げ、中長期で売上高1,000億円への成長を目指す

- 中長期的には**代理店ビジネス**、**ホワイトスペースM&A**を成長ドライバーに加え、更なる成長を図る
- 半導体装置の代理店は単なる仲介業者に留まらず、各装置メーカーの国内におけるいわば“顔”の役割
当社のプラットフォーム力・エンジニアリング力の発揮、強化により既存事業とのシナジーを創出

売上高（流通総額）推移

- ホワイトスペースM&A
- 装置代理店ビジネス
- 装置販売サービス
- 部品・修理サービス



ホワイトスペースM&A

当期より取り組みを始めたM&Aに関して、本中計期間中の実行に向けて進捗中長期のトップラインを押し上げ

代理店ビジネス

韓国装置メーカーと、国内取扱における独占代理店契約締結

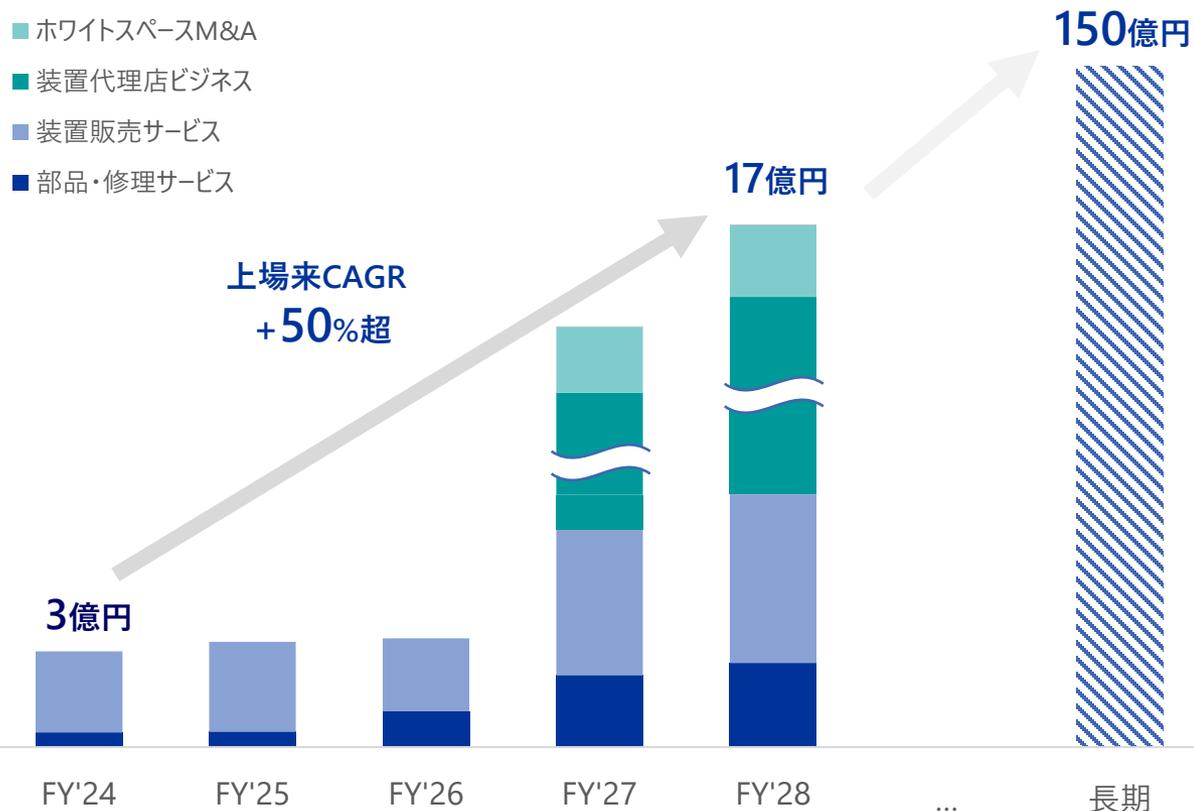
既にFY2027の売上につながる具体的な引き合いがあり、**1台3億円以上×年間数台～数十台の受注確度高**

中長期成長イメージ（営業利益）

高利益事業の成長と収益構造の進化により、営業利益150億円の達成を目指す

- 装置代理店ビジネス、ホワイトスペースM&Aを成長ドライバーに加え、更なる成長を図る
- 利益効率の高い装置代理店ビジネスの成長、増収に伴う固定費率の縮小により
営業利益は上場来CAGR+50%超へ

営業利益推移



装置代理店ビジネスの 高い利益効率

既存の装置販売事業と比して高い利益率の確保が可能、さらなる利益拡大を見込む

増収レバレッジ効果

大幅な増収・固定費率の縮小により利益拡大

FY2026計画および中期計画

FY2026は増益を確保し、FY2028には営業利益17億円超への飛躍的な拡大を目指す

- 装置販売サービスの不確定要素により、FY2026は減収を見込むが、高収益案件及びECの伸長により増益予想
- 中期的には新規事業である装置代理店ビジネスの拡大およびホワイトスペースM&A、これらのシナジー効果により **営業利益17億円超**を見込む

CAGR (単位：百万円)

	FY2025 実績	FY2026 計画	FY2027 計画	FY2028 計画	FY2028 -FY2025比 (増減率)
売上高	8,628	6,112	10,336	12,805	+4,176 (+48.4%)
売上高 (流通総額) *	8,628	6,112	14,153	18,291	+9,662 (+112.0%)
売上総利益	970	1,002	2,967	3,457	+2,486 (+256.3%)
(売上総利益率)	11.2%	16.4%	28.7%	27.0%	+15.8pt
営業利益	355	367	1,421	1,767	+1,411 (+396.9%)
(営業利益率)	4.1%	6.0%	13.8%	13.8%	+9.7pt

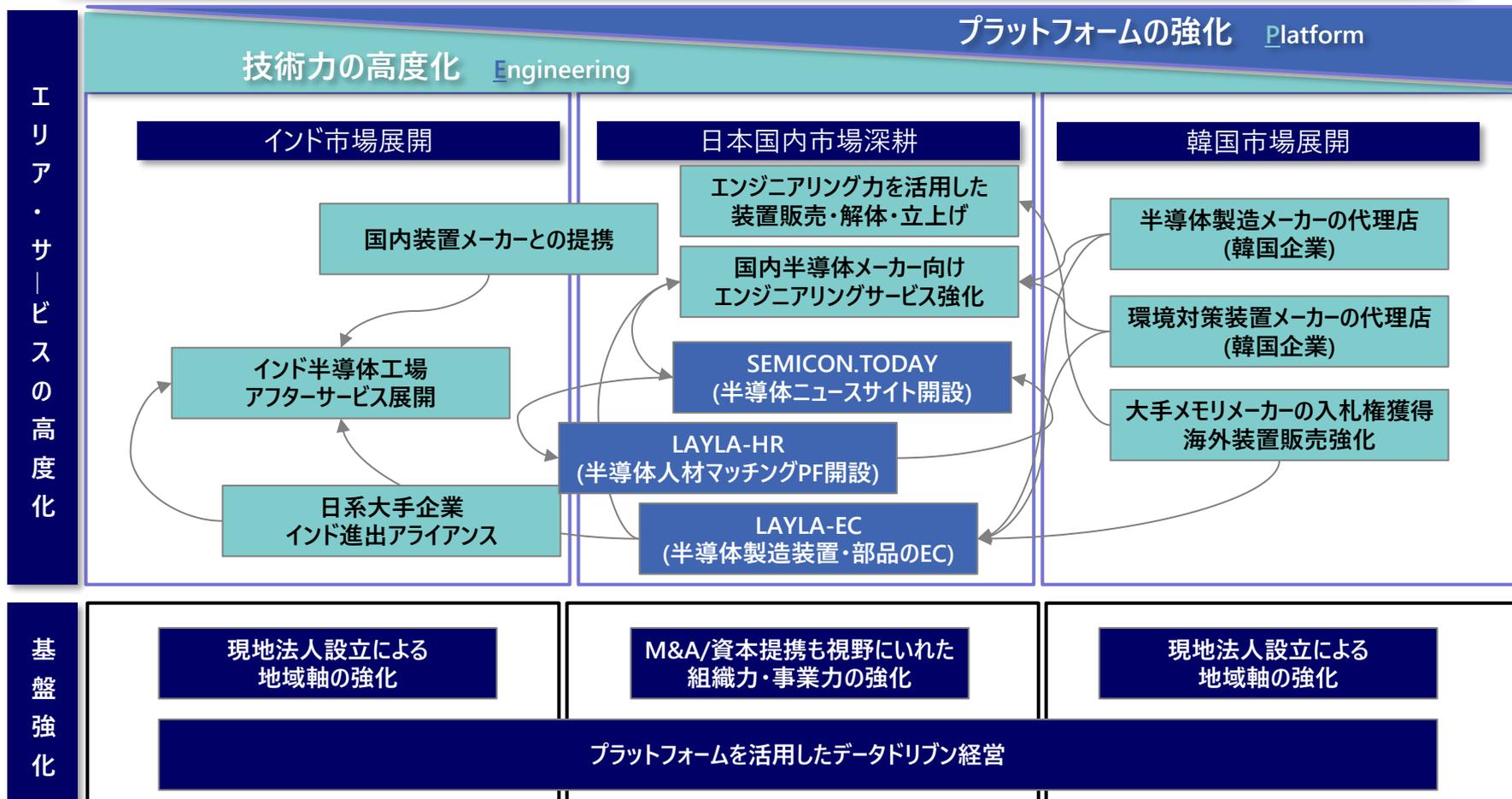
* 装置代理店ビジネスのうち、財務諸表上の売上高と売上原価が純額計上となるものを、総額計上とした場合の数値

中期的なマージンターゲットを実現するための施策

市場・サービス拡大により、売上(流通総額)180億円超、営業利益17億円超を目指す

売上*(流通総額) **180**億円超 営業利益* **17**億円超

Aim 2028



*従来は売上総利益率25%、営業利益率15%を目標としておりましたが、代理店事業の拡大やM&Aによる事業構造の変化を踏まえ、より実効性の高い金額ベースの目標へ変更しております。

SEIZE THE FUTURE '26

FY2026は「SEIZE THE FUTURE」を目標に、シェア拡大と新規事業への積極的な取り組みにより目の前の果実の収穫と共に長期目線での種まきを遂行！「未来を創る」と同時に「市場を奪取する」

FY2026事業方針

シェア拡大によりメンテナンス業界の地位確立

- ・岩盤事業の安定成長（越境ECプラットフォーム等を活用した部品販売・修理サービス）
- ・グローバル規模での調達網基盤を活かしたシェア拡大（エンジニアリング力を活かした装置販売サービス）

新規事業推進による「未来創造」

- ・グローバル企業とのアライアンスによる国内・海外顧客深耕の加速
- ・SEMICON.TODAY及びLAYLA-HR展開加速による半導体産業への貢献

基盤構築による効率化推進

- ・AI活用による意思決定の速度・質の向上
- ・業務改善に関わる社内システムの導入（継続）

中長期的目線でのFY2026の位置づけ

FY2026は「次なる成長ステージへの助走期間」

短期的な市場変動に対応しつつ、中長期的な飛躍を見据えた戦略的投資を実行

	FY2026	中長期
既存事業	装置販売事業のサイクル 不確定要素による一時的な調整局面 △ 踊り場	○
	ECプラットフォームの伸長 継続的な高成長（CAGR +20%超） ○ 成長継続	○

短期的な市場周期影響に対応しつつ、中長期的な成長を見据えた投資を実施

新規展開	装置代理店ビジネス 半導体製造装置メーカーとの代理店ビジネスの開始や、SEMICON.TODAYをはじめとしたプラットフォーム拡張に取り組む。FY2026への業績影響は限定的であるが、既に事業の柱となる目途が立っており、中長期的には重要な成長ドライバーとなる ○ 立ち上げ	◎
	海外展開 海外展開の加速化に伴い、初期投資に関するコストが先行発生 ○ 投資先行	◎
	M&Aグロース M&A戦略のためプロジェクトチーム立ち上げ、FY2026より専門家費用等、検討フェーズに係る費用の先行発生 △～○ 投資先行	◎

06 リスク情報

事業上のリスクと対応策

項目	事業等のリスクの概要	可能性	影響度	顕在化時期	対応策
マクロ経済環境について	半導体は様々な製品に使用されますが、景気や技術革新によって需要が変動します。また、当社ビジネスの商流には、輸入や海外半導体製造工場への輸出も含まれています。そのため、当社の業績は景気、経済動向、技術革新、地政学的リスクによる影響を受ける可能性があります	中	中	短期～長期	リスクコンプライアンス委員会において対処すべきリスクを検討の上、取締役会へ報告する体制を整備しています。また、かかるリスクの発現の兆候を早いタイミングで察知すべく、市場動向や競合状況の調査・分析を行い、顧客との対話を通じたニーズの把握に努めています
為替変動について	台湾や韓国、米国などの海外から部品等を輸入しています。当社が輸入において使用する外貨（主に米ドル）が円安に転じた場合、仕入コストの上昇に繋がる可能性があります	中	中	特定時期なし	為替変動による仕入れコストの上昇を、販売価格に転嫁するよう努めています。 また、輸入取引に関連して、契約時の前払等を活用した為替リスクのヘッジに継続的に取り組んでおります
主要顧客への依存について	寡占の進む半導体業界は、大手による市場シェアが高い環境となっています。かかる環境を背景に、当社の売上高は、大手半導体メーカー向けの割合が比較的大きく、大手半導体メーカーの投資動向の影響を受けやすい傾向にあります	中	中	特定時期なし	きめ細かい顧客との対話を通じて、主要顧客各社の動向の把握に努めるとともに、新規顧客の開拓を進めて参ります
調達について	特に装置販売ビジネスにおいては、新たな設備投資を先行させる特定の手半導体メーカーからの、中古装置・部品の調達が多い状況です。したがって、何らかの理由により仕入先からの供給の停止が生じた場合、当社による調達が停滞する可能性があります	小	中	特定時期なし	200社を超える世界中のサプライヤーと関係を構築しています。またこれらのサプライヤーの有する在庫情報を常時収集し、顧客ニーズへの柔軟な対応を可能とすべく幅広い調達先を確保し、特定サプライヤーへの依存を下げるよう努めています
人材の確保および育成について	地方に本社を構えることに起因する採用競争力への影響が生じる場合や、人材の育成・定着が計画どおり進まない場合には、事業拡大の制約となる可能性があります	中	大	特定時期なし	継続的に有能な人材の確保に努めるとともに、人材の育成・定着に資する会社のカルチャー醸成・その浸透、また人事制度や職場環境の更なる改善を図ってまいります

上記には、当社が経営においてリスク要因となる可能性があると考える主な事項について記載しています。

資金使途

上場時における調達予定資金（予定金額3.76億円）の使途内訳は以下の通り

調達した資金は、韓国における海外子会社の設立、
新たなプラットフォーム構築、人材採用に重点的に活用

単位：千円

項目	上場時 予定金額	使途実績・予定額	
		2025年11月期 実績	2026年11月期以降
広告宣伝費	4,000	4,000	-
中部支店 設備投資	20,000	-	-
子会社設立資金	-	86,000	-
LAYLA等のシステム開発費用	81,000	15,000	-
採用費用および人件費	271,366	100,000	147,078
合計	376,366	205,000	147,078

2025年6月13日付で公表いたしました「上場調達資金使途変更に関するお知らせ」に基づき、資金使途実績・予定金額を変更しております

免責事項

本資料は、当社の業界動向及び事業内容について、現時点における予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来展望についても言及しております。

これらの将来展望に関する表明の中には、様々なリスクや不確実性が内在します。既に知られたもしくは未だに知られていないリスク、不確実性その他の要因が、将来の展望に関する表明に含まれる内容と異なる結果を引き起こす可能性がございます。

当社の実際の将来における事業内容や業績等は、本資料に記載されている将来展望と異なる場合がございます。

本資料における将来展望に関する表明は、2026年2月現在において利用可能な情報に基づいて当社によりなされたものであり、当社として将来の結果や業績を保証するものではないことにご留意ください。

成長可能性資料の次回開示（更新）は、2027年2月末日までの公表を予定しております。